**國家中山科學研究院106年人力進用招考甄試簡章**

**壹、員額需求：**

需求全時工作人員研發類164員、技術類180員，共計344員，依「國家中山科學研究院106年人力進用員額需求表」辦理（如附件1）。

**貳、薪資及待遇：**

一、薪資：依招考公告薪資總額基準表面議，惟薪資總額區分基本薪及變動薪，基本薪依公告職缺之限定學歷核給，其餘金額列入變動薪。

二、福利、待遇：

(一)享勞保、健保及依勞工退休金條例第14條按月提繳退休金。

(二)可申請員工宿舍。

(三)年終工作獎金之發放，依本院訂頒之「年終工作獎金發放作業規定」及「員工工作規則」辦理。

(四)因任務需要超時工作，依本院「員工工作規則」辦理。

(五)詳細待遇及權利義務內容於本院「勞動契約」訂定之。

(六)支領退休俸之退伍軍士官再任本院員工，依「陸海空軍軍官服役條例」第32條規定及立法院決議事項(按所任職務薪資減月退休俸減優存利息之差額支給)辦理。

(七)公務人員退休人員再任本院員工，依「公務人員退休法及其施行細則」規定辦理。

(八)退休教職員再任本院員工，依「學校教職員退休條例及其施行細則」規定辦理。

**參、報考資格：**

一、國籍：具中華民國國籍，並在臺灣、澎湖、金門、馬祖地區設有戶籍者。

二、學、經歷：教育部評鑑合格之各大學院校相關系所畢業(持國外學歷者須符合教育部頒「大學辦理國外學歷採認辦法」之資格)。

(一)研發類：

1.國內、外各大學院校理、工學院碩士/博士畢業，其學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。學歷認定以員額需求表所需學歷之畢業證書記載為準，如非理、工學院畢業者，其理工相關課程學分需超過總學分三分之二以上，同時論文題目需與理、工相關，且為本院研發任務所需之專長；前述理、工相關課程學分需超過總學分三分之二以上之規定，可檢具論文、成績單及學校開立證明書認定，或檢具學分證明資料由本院專業單位審查。

2.非理工學院之特殊領域相關系所碩士(含)以上學歷畢業之特殊人才，依本院「特殊領域人才進用作業規定」(如附件2)審認。

3.同等學力不予運用。

4.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

(二)技術類：

1.高中、職(含)以上學歷畢業。

2.學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件者。

3.同等學力不予運用。

4.報考人員若高於該職缺「學歷」，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

三、其他限制：具有下列情形之一者，不得辦理進用；若於進用後，本院始查知具下列限制條件者，因自始即未符合報考資格，本院得取消錄取資格，並不得提出異議︰

(一)中國籍之大陸地區或港澳地區人士。

(二)無行為能力或限制行為能力者。

(三)曾因違反毒品危害防制條例案件，受觀察勒戒、強制戒治及刑之宣告者。

(四)犯內亂、外患、貪污罪及違反國家機密保護法，經判決有罪者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(五)曾犯前款以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑，尚未執行或執行未完畢者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(六)因案被通緝或在羈押、管收中。

(七)依法停止任用者。

(八)褫奪公權尚未復權者。

(九)受監護宣告尚未撤銷者。

(十)於本院服務期間，因有損本院行為，遭解僱或以不勝任人員資遣者。

(十一)本院各級主管之配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。

(十二)因品德、操守或違反資安規定遭任職單位核予大過(含)以上之懲罰者。

**肆、報名時間及方式：**

一、甄試簡章刊登於本院全球資訊網(<http://www.ncsist.org.tw>)

，公告日期至106年11月13日止(公告時間自實際公告日起30日止，遇假日延後兩天)。

二、職缺刊登於本院網路徵才系統(<https://join.ncsist.org.tw>)

，職缺公告截止日為實際公告日期加計各單位公告天數(如附件3)，遇假日延後兩天。

三、 符合報考資格者，需至本院網路徵才系統(https://join.ncsist.org.tw)填寫個人資料及上傳履歷表(貼妥照片，格式如附件4)、學歷、經歷、成績單、英文檢定證明、論文、期刊發表、證照、證書等相關資料後，選擇報考職缺並投遞履歷，各項資料並依序彙整在同一檔案(PDF檔)上傳。

四、需求單位於本院徵才系統資料庫搜尋並篩選符合報考資格者後

，辦理書面審查(或資格審查)。

五、報考人員經書面審查 (或資格審查)合格者，需求單位以電子郵件、書面或簡訊(可擇一)通知參加甄試。

六、不接受紙本及現場報名甄試。

七、若為本(106)年度應屆畢業生或延畢生(報名甄試時尚未取得畢業證書者)，報名時得先不繳交畢業證書影本，但需繳交學生證影本查驗。前述人員錄取後，需於本院寄發通知日起3個月內(報到前)繳驗畢業證書，若無法於時限內繳驗，則取消錄取資格。

八、歡迎具身心障礙身分或原住民族身分，且符合報考資格者報名參加甄試，並於人才資料庫登錄資料時註記。

九、為提供本院聘雇員工職類轉換管道，本次招考開放院內符合報考資格之員工，可報名參加甄試。本院員工報名甄試者，不可報考同一職類，且需經單位一級主管同意後(報名申請表如附件5)，於本院網路徵才系統完成報名。另當事人需填具工作經歷(非職稱)後，由該工作經歷任職單位二級主管核章，無需檢附勞保明細表。

**伍、報名應檢附資料：**報名資料未繳交齊全或資料內容無法辨識者，視同資格不符。**各項資料依序彙整於同一檔案上傳。**

一、履歷表(如附件4），並依誠信原則，確實填寫在本院服務之親屬及朋友關係，若未誠實填寫而錄取，本院**得**予不經預告終止契約解除聘雇。

二、符合報考學歷之畢業證書。

三、報考所需之個人相關資料(如：工作經歷證明、證照、成績單或英文檢定成績等，請參考簡章之員額需求表)。

四、提供工作經歷證明者，格式不限，但需由公司蓋章認可，內容需註明從事之工作內容(非職稱)及任職時間。

五、若有繳交民營機構之工作經歷證明，需再檢附「勞保明細表」，未檢附勞保明細表者，該工作經歷不予認可。

六、具身心障礙身分者，檢附身心障礙手冊(證明)正、反面。

七、具原住民族身分者，檢附戶口名簿或戶籍謄本，並標記族別。

八、主管核章之申請表正本(僅本院同仁需繳交)。

**陸、甄試時間、地點及方式：**

一、甄試日期及時間：暫定106年11-12月 (實際甄試時間以甄試通知為準)。。

二、甄試地點：暫定本院新新或龍門院區(實際甄試地點以甄試通知單為準)。

三、甄試方式：

(一)研發類：

1.初試：甄試科目及配分請參閱員額需求表。

2.通過初試者視需於複試前參加性格特質測驗。

3.複試：口試作業。

(二)技術類：甄試科目及配分請參閱員額需求表。

**柒、錄取標準：**

一、甄試合格標準：

(一)初試單項(書面審查/口試/實作/筆試)成績合格標準請參閱員額需求表，未達合格標準者不予錄取。

(二)複試(口試)合格標準為70分(滿分100分)。

(三)初、複試總成績合格標準為70分(滿分100分)。

(四)如有其中一項甄試項目缺考者，不予計算總分，且不予錄取。

二、成績排序：

(一)以總成績高低依序錄取。

1.研發類：總成績為複試(口試)平均成績。

2.技術類：總成績為各單項成績依比例計算後加總。

(二)總成績相同時：

1.研發類：依序以初試總成績、口試平均成績、書面審查平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由需求單位決定錄取順序。

2.技術類：依序以實作平均成績/筆試成績(若採二者併行，則依序以實作平均成績為優先，筆試成績次之)、口試平均成績較高者為優先；遇所有成績均相同時，由需求單位決定錄取順序。

三、備取人數及儲備期限：

(一)招考員額4員以下：備取人數以2員為限。

(二)招考員額5員以上：備取人數以3員為限。

(三)備取人員儲備期限自甄試結果奉權責長官核批次日起4個月內有效。

**捌、錄取通知：**

一、甄試結果預由本院於甄試後一個月內寄發通知單(或以電子郵件通知)，各職缺錄取情形不予公告。

二、人員進用：錄取人員參加權利義務說明會後，再辦理報到作業。錄取人員試用3個月，試用期間經考核為不適任人員，予以資遣並核予資遣費。

三、人員錄取或遞補後，其他招考職缺之錄取或遞補皆需自動放棄。

**玖、如有任何問題歡迎電詢聯絡人員(如附件3)。**

附件1

| **國家中山科學研究院106年人力進用員額需求表** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **需求**  **單位** | **職類** | **學歷**  **需求** | **薪資**  **範圍** | **專長**  **(技能)** | **學歷、經歷條件** | **工作內容** | **需求**  **員額** | **工作**  **地點** | **甄試**  **方式** |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械 | 1.機械工程/電子電機/工業工程等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文、技術士技能檢定證照)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具有系統工程整合或模擬分析等相關工作經驗。  (2)熟悉國防科技研發等相關理論與實務經驗。  (3)熟悉Matlab、Simulink  、Excel、VBA、Solidworks  、AutoCAD等相關工  具。  (4)具國家考試資格、技術士技能檢定。  (5)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.武器系統需求分析、設計、規劃與測試評估。  2.武器系統工程整合及模擬分析。  3.執行專案計畫建案與管制。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 工業工程 | 1.機械工桯/航空工程/工業工程/工業管理等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文、技術士技能檢定證照)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有專案管理/系統工程/生產管理相關工作經驗為佳(請檢附證明資料)。 | 專案計畫管理與系統工程整合之相關管制工作。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 航空/機械 | 1.航空/機械等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.有從事過與推進相關研發工作經驗為佳(請檢附證明資料)。 | 1.各型火箭發動機之研發，包括設計、測試、分析等工作。  2.系統工程，包括系統規劃、分析，介面協調、整合等工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 航空/機械 | 1.航空/機械等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)曾從事風洞設備相關研究或具有試驗實務經驗。  (2)具氣體動力學/燃燒學等相關領域之研究經驗。 | 1.風洞試驗之實驗設計、氣動力分析、工作整合規劃、執行協調管制、與數據處理分析。  2.風洞試驗設備與相關元件之氣動力分析設計與系統整合規劃。  3.前瞻風洞試驗技術與設備能量之研究開發、專案規劃建立、執行推動與管理。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械 | 1.機械/航空/應用力學/ 造船等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列工作經驗者為佳(請檢附證明資料)：  (1)從事機械結構設計相關工作經驗1年(含)以上。  (2)熟悉下列軟體之一: Pro/E、SOLIDWORKS。  (3)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公/民營機構訓練證照或證明。 | 1.各型彈體結構之研發、系統工程等相關工作。  2.水下載具結構、 機構與關鍵組件設計。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機/電力 | 1.電子/電機/電力等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)熟悉品質工程/量測檢驗與NI測試程式語言/具品保相關證照。  (2)具電子電路整合設計與檢修能力/常用檢測儀器使用能力/元件市場尋求作業能力。  (3)電力系統測試維護/佈線施工及電力電子訊號量測相關工作經驗。  (4)具國家考試資格/技術士技能檢定。 | 1.執行電子、電機類檢驗與測試、測試設備/測試程序規劃與管制。  2.品質管理作業規畫與管制。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械 | 1.機械相關理工系所畢業。  2.書面審查須檢附大學及研究所各學年在校成績單(未檢附者，視同資格不符)與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(需檢附證明資料)。  4.對機械檢驗相關工作有興趣者。  5.具備下列資格條件之一者為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械識圖能力或經驗。  (2)具三次元量床操作經驗。  (3)具品質檢驗工作經驗。  (4)具機械加工、電腦輔助機械設計製圖等技術士技能檢定相關證照。 | 1.執行精密機械零件、組件等尺碼、機械性能等檢驗工作、規劃與管制。  2.執行品質檢測設備規劃與開發工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械 | 1.物理/材料工程/機械工桯/航空工程/電機工程等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績IBT65/CBT170  /PBT500)以上者，免英文筆試(需檢附證明資料)。  4.具有下列工作經驗者為佳 (請檢附證明資料)：  (1)具機構設計與分析相關工作經驗者。  (2)具ANSYS/SolidWorks /AutoCAD軟體相關工作經驗者。  (3)具材料力學，振動與衝擊力學分析相關工作經驗者。 | 1.機構設計。  2.產品抗振動與衝擊性能的設計、測試與分析。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 航空/機械 | 1.航空/機械/電機/工程科學/系統工程/土木等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具飛行控制設計、導引律設計及數位模擬，並熟悉飛行力學、軌道力學。  (2)熟悉Matlab/Simulink  、C、C++與Java語言及Windows與Linux作業環境。 | 1.飛行載具導引律設計。  2.飛行載具控制律、飛行控制系統(自動駕駛儀)設計。  3.全數位模擬驗證。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 博士  畢業 | 75,000  |  85,000 | 航空/機械 | 1.航空/機械/電機/工程科學/系統工程/土木等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具飛行控制設計、導引律設計及數位模擬，並熟悉飛行力學、軌道力學、系統識別與訊號處理。  (2)熟悉Matlab/Simulink  、C、C++與Java語言及Windows與Linux作業環境。 | 1.飛行載具導引律設計。  2.飛行載具控制律、飛行控制系統(自動駕駛儀)設計。  3.全數位模擬驗證。  4.系統識別與建模。  5.訊號處理與濾波器設計。 | 1員 | 桃園龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械 | 1.機械/航空等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械類加工製造檢驗與品質管理工作經驗。  (2)具資訊安全管理工作經驗。 | 1.精密機械零組件檢驗及相關品質統計及變異分析等品質管理工作。  2.檢驗夾治具設計開發。  3.檢測實驗室品質系統工作執行。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 航空/機械 | 1.航空/機械等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具流體機械設計/測試相關工作經驗。  (2)具組件機構設計/3D繪圖相關工作經驗。 | 1.機械零組件之設計/測試/分析。  2.機構設計/3D繪圖。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 航空/機械 | 1.機械/航空/應用力學/造船等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械設計能力，熟悉下列軟體其中之一Pro/E、SOLIDWORK。  (2)具有限元素分析軟體使用經驗。  (3)具液/氣壓系統設計經驗。  (4)具公/民營機構訓練證照或證明。 | 1.液/氣壓系統研發設計。  2.機械零組件設計、分析、製造、組裝、測試等工作。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/控制/電信/光電/資工等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具下列開發經驗之  一：C++/C#/Java/  Linux/Visual Basic/  Matlab/LabVIEW/內嵌式程式。  (2)具軟體通信與數位信號處理經驗。  (3)具類比、數位電路、單晶片設計經驗。 | 1.軟體/韌體、DSP數位電路及微控制器軟硬體開發研製。  2.系統核心設計與測試、系統分析模擬。  3.通訊程式、機構控制軟體開發。  4.類比伺服控制器電路研製、人機操控介面程式設計。  5.電子、電力、通信、系統整合、控制。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/控制/電信/光電/資訊工程等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具微處理器、DSP、FPGA等嵌入式系統開發工作經驗。  (2)具C/C++/Java電腦語言能力，撰寫中層驅動界面程式工作經驗。  (3)具軟體通信與數位信號處理工作經驗。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。 | 1.軟體/韌體、DSP數位電路及微控制器軟硬體開發研製。  2.通訊程式、人機操控介面程式設計。  3.通信、系統整合、控制軟體開發。  4.系統核心設計與測試、系統分析模擬。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機、機械、動機所控制組等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)熟悉C/C++、Visual Basic、Matlab、LabVIEW等任一軟體。  (2)具類比、數位電路設計經驗。  (3)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.DSP數位電路及微控制器軟硬體開發研製。  2.類比伺服控制器電路研製。  3.人機操控介面程式設計及系統測試。  4.機電整合專案。  5.無刷馬達控制。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械/航空/自動控制 | 1.機械/航空/自動控制/電機/動機等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)熟悉Pro/E、SolidWorks  、Matlab、LabView  等軟體。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.液/氣壓伺服控制系統研發及系統工程整合。  2.視任務需求，需配合出差執行裝備/系統安裝與測試等相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/光電/資訊工程等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具電子/電機/光電/資訊工程相關工作經驗。  (2)具C語言或LabVIEW開發經驗、認證。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。 | 1.類比及數位控制電路設計、分析與驗測。  2.PXI模組化測試系統研發設計。  3.電控裝備故障隔離及排除。  4.測試器軟體開發、崁入式系統應用開發。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具有電源系統及功率轉換器模擬分析、硬體研製及DSP韌體撰寫等相關工作。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。 | 1.電源系統模擬、  分析、設計、研製及測試。  2.高功率模組模擬、分析、設計、研製及測試。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械 | 1.電子/電機/機械等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)熟悉車體、支援裝備研發流程，曾執行相關系統整合、工程設計及分析、製程改善、成本分析、作業研究等研發專案相關工作經驗一年(含)以上。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (3)具國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。 | 1.執行車體之系統整合設計、結構分析、組裝測試及演訓驗證事宜。  2.執行支援裝備之系統整合設計、結構分析、組裝測試及演訓驗證事宜。  3.執行車體暨支援裝備之售後技術服務及後續維持相關事宜。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機電/控制 | 1.機械/航空/電機/控制/機電整合等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)熟悉自動控制、機電整合技術，曾執行相關研發專案相關工作經驗一年以上。  (2)具備自動化機械開發經驗或相關證照。 | 1.金屬3D列印設備開發。  2.執行各專案機電整合系統規劃與設計。  3.執行生產計畫各專案機電裝備籌獲。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械/航空 | 1.機械/航空/材料等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)熟悉結構力學、金屬材料力學等專業，曾執行相關研發專案相關工作經驗一年以上。  (2)具備傳統加工製造（如鑄造、機械加工）經驗或相關證照。 | 1.金屬3D列印設備開發。  2.執行各專案關鍵零組件設計開發。  3.執行生產計畫各專案機械裝備籌獲。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械 | 1.機械相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.熟悉且具備一年(含)以上機械類3D電腦輔助設計經驗與2維與3維圖檔資料資訊化管理實務經驗。需提供相關工作證明，或具備相關證照(以上二擇一)。  5.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具Oracle DB管理經驗或虛擬伺服器Vmware實務經驗為佳。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。 | 1.機械類電腦輔助設計3維圖檔資料輕量化技術應用研究與相關之計畫專案管理  2.3維CAD資料庫虛擬伺服器(VMware)建置規劃與數據分析 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械 | 1.機械相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具一年以上機械設計或或生產製程管理等經驗(請檢附證明資料)。 | 1.機械類產品生產製程(BOP)分析，及人機資源規劃。  2.生產工程與管理之產製資訊大數據分析 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 航空/機械 | 1.機械/航空等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械設計/加工/製造及產品製程規劃等技術及工作經驗。  (2)曾從事機械設備開發等相關工作經驗1年(含)以上。  (3)具備CAD/CAM製程設計經驗。  (4)具備航太零組件設計與機械製造實務經驗。  (5)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 機械設計、加工、製造及產品製程規劃、研發、測試、分析等工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 航空/機械 | 1.機械/航空等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具有機械設計、加工、製造及產品製程規劃等技術及工作經驗。  (2)曾從事機械設備開發等相關工作經驗1年(含)以上。  (3)具備CAD/CAM製程設計經驗。  (4)具備航太零組件設計與機械製造實務經驗。  (5) 熟悉機械設計Pro/E、Solid Works繪圖軟體、Matlab、LabVIEW軟體。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.機械設計、加工、製造及產品製程規劃、研發、測試、分析等工作。  2.精密慣性儀具零組件製作研發及產品組裝、測試、分析等工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 航空/機械 | 1.機械/航空/造船等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具有下列資格條件之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)具有機械設計、加工、製造及產品製程規劃等技術及工作經驗。  (2)曾從事機械設備開發等相關工作經驗1年(含)以上。  (3)具備CAD/CAM製程設計經驗。  (4)具備航太零組件設計與機械製造實務經驗。  (5)熟悉機械設計PRO/E  、SOLIDWORKS繪圖軟  體。  (6)熟悉Matlab、LabVIEW軟體、單晶片控制技術或C/C++語言。  (7)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.機械設計、加工、製造及產品製程規劃、研發、測試、分析等工作。  2.伺服控制系統設計、微控制器軟硬體開發研製、人機操控介面設計。 | 5員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 化學/化工 | 1.化學/化工等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具表面處理相關工作經驗為佳(請檢附相關工作經歷證明)。 | 表面處理、電鍍及塗裝製程開發與生產作業。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 化學/化工 | 1.化學/化工/材料等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.英文具有全民英檢中高級初試通過/TOEIC 650(含)以上/托福成績(IBT65/CBT170/  PBT500)以上，免英文筆試(請檢附證明資料)。  4.具電路裸板製作相關工作經驗為佳(請檢附相關工作經歷證明)。 | 電路裸板製程開發與生產作業。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **筆試：**英文  (60分合格，  無條件3之證明資料者，需參加英文筆試）  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機等相關科系畢業。  2.具工作內容所列項目相關經驗為佳(請檢附證明資料)。  3.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：  (1)具電子物料識別能力。  (2)具備倉儲管理概念。  (3)具物管實務經驗。 | 1.電子料件庫房倉儲管理，及物料系統帳務處理。  2.其他物料管理及申購業務。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **筆試60%：**  基本電學  參考書籍：  電子學  (作者：楊善國;全華出版社)  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試 40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業；其他理工及非理工科系畢業者，需具3年以上機械相關工作經驗(請檢附證明資料)。  2.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械相關乙級技 術士證照  (2)具工具機操作工作經驗。  (3)具三噸以上固定式起重機和堆高機訓練合格。 | 1.鋸床操作。  2.水刀切割機操作。  3.剪床操作。  4.其他物料管理及申購業務。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  鋸床或水刀  實作範圍：  機械操作金屬裁切  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試 40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 高中  (職)  畢業 | 30,000  |  37,000 | 機械 | 1.高中/職畢業，具鉗工丙級以上技術士證照(需檢附證照影本)。  2.具機械相關內容工作1年(含)以上經驗(請檢附相關工作經歷證明)。  3.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械、組測、液/氣壓或維修產品相關工作經驗1年(含)以上。  (2)具機械加工(車、銑等)或機具設備(起重機、堆高機、高特等)操作證照。  (3)具液壓、氣壓或鉗工技術士證照。  (4)具機械加工或機具設備(起重機、堆高機、高特等)操作相關證照。 | 可從事以下工作之一：  1.執行科研及生產案液/氣壓及機電系統組裝測試。  2.執行各演訓任務液/氣壓、機械裝備與系統配置、組裝測試等相關工作。  3.液/氣壓系統零組件加工(車、銑、鉗工)。  4.3000psi以上高壓氣體配管。  5.高壓氣體設備組測、操作與維護。  6.武器系統和裝備的組裝、使用、維修、保養等工作。  7.武器系統硬品攻牙、上螺襯及組裝等。  8.彈體翼翅模組組裝調校及測試驗證。  9.彈體與發射系統機械模組組裝、修配及測試驗證。  10.陣地部署與艦艇架控系統維護及測試。  11.執行武器系統和裝備的組裝、使用、維修、保養等工作。  12.機械設備、模組組裝、修配及測試。  13.操作固定式起重機、堆高機、高壓氣體特定設備等機具設備。 | 11員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  鉗工  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業；其他理工及非理工科系畢業者，需具機械相關乙級技術士證照(請檢附證明資料)。  2.具備下列資格條件之ㄧ為佳 (請檢附證明資料) ：  (1)具機械、組測、液/氣壓或維修產品相關工作經驗1年(含)以上。  (2)具機械加工(車、銑、鉗等)或機具設備(起重機、堆高機、高特等)操作相關證照。  (3)孰悉機械2D或3D繪圖或具機械繪圖證照。  (4)具液氣壓類工作經驗。 | 可從事以下工作之一:  1.試驗或液壓設備安裝拆卸、保養維修。  2.機械設備繪圖、傳統及數值機械加工。  3.操作固定式起重機、堆高機、高壓氣體特定設備等機具設備。  4.機械設備、模組組裝、修配及測試。  5.執行武器系統和裝備的組裝、使用、維修、保養、定期安全檢查等工作。 | 4員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  鉗工  實作範圍：  組裝、修配、  夾製具製作  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業；其他理工及非理工科系者，需具需具機械相關乙級技術士證照(請檢附證明資料)。  2.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：  (1)具鉗工、車铣、銲接加工等機械相關經驗。  (2)具機械相關技術證照。 | 1.鋁合金濕硬銲製作。  2.零組件鉗工、車銑、氬銲加工。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  濕硬銲、氬銲實作  實作範圍：  1.濕硬銲零組件銲料佈置與夾具組立實作  2.氬銲實作  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 機械 | 1.機械/電機等相關科系畢業。  2.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械相關電腦繪圖工作經驗1年(含)以上。  (2)具各公營機構機械相關電腦繪圖技能訓練合格證明(請檢附訓練時數300小時以上相關證明)。  (3)具機械類電腦繪圖乙級證照。  (4)具PRO/E、AUTOCAD  、SOLIDWORKS等繪圖與設計能力。  (5)具有全民英檢/TOEIC  /托福等相關英文成績證明。 | 主要執行3D/2D機械及機構設計與工程圖繪製相關工作。並可配合從事下列之部分工作項目：  1.執行機械組裝測試、料件籌購、入出庫及生管等作業。  2.英文工程圖繪製與相關英文手冊協編。  3.執行後勤補給手冊與電子書圖檔製作。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  電腦繪製工程圖  【使用SolidWorks軟體】  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試 40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 高中  (職)  畢業 | 30,000  |  37,000 | 機械 | 1.機械等相關科系畢業。  2.具Solid-Works、Auto-Cad  等繪圖與設計能力，持有證照或結訓證書為佳(請檢附證明資料)。  3.具與工作內容相關工作2年(含)以上經歷為佳(請檢附證明資料)。 | 1.操控系統機櫃研發設計與繪圖。  2.機械加工夾治具設計與繪圖。  3.機械電腦製圖。  4.執行3D/2D機械設計及藍圖繪製相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **筆試60%：**  電腦繪圖  筆試範圍：  機械繪圖原理、  電腦3D繪圖要領  及基本機械設計  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/電力控制/資訊等相關科系畢業。其他理工及非理工科系畢業者，需具電子電機相關乙級技術士證照(請檢附證明資料)。  2.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：  (1)具電子、電機、電力控制、電路板檢測或儀錶相關工作經驗1年(含)以上。  (2)具室內配線或電路板錫焊工作經驗1年(含)以上。  (3)具丙級以上電機電子類技術士證照。  (4)可資佐證符合專長(技能)或工作內容請求之公、民營機構訓練證照或證明。  (5)具備MS Office軟體操作能力。  (6)具物料管理工作經驗。 | 可從事下列工作之一：  1.儀電模組製作、線路配接、機台操作與維護工作。  2.電路製作、接頭接線製作  、佈線施工組裝及電路板訊號檢修。  3.裝備操作、訊號模擬與量測、電子設備檢修。  4.電路焊接、組裝、測試。  5.BOM表建立及料件管理。  6.協助演習出差相關工作。  7.執行線束佈線施工及訊號量測、接頭與電子電路製作。  8.執行各類型測試器測試維護、線束測試、線束佈線施工及訊號量測。  9.執行各項任務裝備系統安裝、測試等相關工作。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  錫焊  實作範圍：  1.依電路圖按圖施工  2.電子零件腳位與極性辨識  3.電烙鐵…等基本工具的使用能力  4.儀表的操作  5.應試者需自備鉗子、電烙鐵、焊錫、數位電表…等工具  6.電源供應器與示波器由考試單位準備  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 高中  (職)  畢業 | 30,000  |  37,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機等相關科系畢業。  2.具電子/電機相關丙級(含)以上技術士證照(請檢附證明資料)。  3.具電子/電機相關工作經驗1年(含)以上 (請檢附證明資料)。 | 1.組裝佈線。  2.模組組裝。  3.系統聯測。  4.電子設備檢修。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  電子電路製作  實作範圍：  電子電路製作  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試 40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業。  2.對機械檢驗相關工作有興趣。  3.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械類加工製造檢驗、機械識圖與品質管制/檢驗工作經驗或技術士技能檢定相關證照。  (2)具三次元量床操作及程式撰寫經驗。 | 可從事下列工作之一：  1.精密機械零組件檢驗、機械性能等檢驗及品質管制工作。  2.執行機械零扣件進料檢驗。 | 6員 | 桃園  龍潭 | **筆試60%****：**  機械視圖與品質管理  參考書籍:  1.品質管制  (中興管理顧問公司發行劉振譯)或一般品質管制書籍  2.幾何尺寸與公差  (中央圖書出版社 許兆年、詹安仁、 林榮慶編譯)  3.抽樣檢驗  (中華民國品質學會張有成編著)或其它抽樣檢驗書籍  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 工業工程 | 1.工業工程相關科系畢業。  2.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：  (1)具品管統計、品保或機械檢測或專案管理工作經驗。  (2)具資訊安全管理工作經驗。  (3)具機械視圖能力。 | 1.精密機械零組件檢驗品質統計及變異分析與品質管理。  2.品質文件資料建立及實驗室認證系統維護。  3.專案管理工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **筆試60%：**  機械視圖與品質管理  參考書籍:  1.品質管制  (中興管理顧問公司發行劉振譯)或一般品質管制書籍  2.幾何尺寸與公差  (中央圖書出版社 許兆年、詹安仁、 林榮慶編譯)  3.抽樣檢驗  (中華民國品質學會張有成編著)或其它抽樣檢驗書籍  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 電子/電機 | 1.光電/機械/電子電機等相關科系畢業。  2.具光纖光學零組件組裝與測相關工作經驗1年(含)以上為佳(請檢附證明資料)。 | 1.光纖光學組件組裝與測試。  2.光纖熔接機台維護。  3.導航系統模組測試、與測試機台維護。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  光纖光學組件組裝  實作範圍：  1.125um-125um光纖熔接  2.125um-80um-80um光纖熔接  3.收線80um光纖於一個圓柱上，限時5分鐘  4.光纖熔接機、光纖剝皮鉗、光纖切割刀由考試單位準備，實作前會先進行設備器械的使用說明  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 電子/電機/機械 | 1.電子/電機/機械等相關科系畢業。  2.具電磁相容相關業務之TAF認證申請經驗為佳(請檢附證明資料)。  3.具執行電磁隔離度檢測工作經驗為佳(請檢附證明資料)。  4.具品質管理及相關文件撰寫工作經驗為佳(請檢附證明資料)。  5.熟悉MS Office軟體(含Project)操作，具相關證照為佳(請檢附證明資料)。 | 1.協助執行TAF認證申請。  2.協助執行電磁隔離度檢測。  3.協助執行品質管理。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  儀器操作  實作範圍：  網路分析儀  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 高中  (職)  畢業 | 30,000  |  37,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業。  2.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：  (1)具操作銑床加工經驗(需檢附工作證明或公立職訓中心上課證明)。  (2)具備製程規劃與藍圖視圖能力。  (3)CNC或傳統銑床乙級(含)以上技術士證照。 | 可從事下列工作之一：  1.武器系統各機械零組件銑床加工等相關工作。  2.生產管制，現場機力排程協調。  3.機械或精密另件銑床加工製造。  4.CNC銑床加工程式撰寫等相關工作。  5.複合材料工件銑床加工。  6.線切割加工。 | 6員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  銑工  實作範圍：  NC銑床加工  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 高中  (職)  畢業 | 30,000  |  37,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業。  2.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：  (1)具操作車床加工經驗(需檢附工作證明或公立職訓中心上課證明)。  (2)具備製程規劃與藍圖視圖能力。  (3)CNC或傳統車床乙級(含)以上技術士證照。 | 可從事下列工作之一：  1.武器系統各機械零組件車床加工等相關工作。  2.機械或精密另件車床加工製造。  3.CNC車床加工式撰寫等相關工作。  4.複合材料工件車床加工。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  車工  實作範圍：  傳統車床加工  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 高中  (職)  畢業 | 30,000  |  37,000 | 機械 | 1.機械/電子/電機等相關科系畢業。  2.具氬氣鎢極電銲單一級(含)以上技術證照 (請檢附證明資料)。  3.具銲接工作經驗2年(含)以上為佳(請檢附證明資料)。 | 1.鋁合金工件銲接。  2.碳鋼或鉻鉬鋼材料銲接。  3.鈦合金與鎳基合金等材料銲接。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  銲接  實作範圍：  鋁合金或碳鋼銲接  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 高中  (職)  畢業 | 30,000  |  37,000 | 機械 | 1.機械/鈑金/冷作等相關科系畢業。  2.具鈑金/冷作相關丙級(含)以上技術證照(請檢附證明資料)。  3.具鈑金或冷作工作2年(含)以上經驗為佳 (請檢附證明資料)。 | 1.鈑金折彎、旋壓及捲製成型工作。  2.各種材料捲管、  修配與整型工作。  3.電控系統箱櫃、  車廂製作、修改與組裝工作。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  鈑金或冷作  實作範圍：  鈑金展開技術  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 高中  (職)  畢業 | 30,000  |  37,000 | 機械 | 1.機械/材料等相關科系畢業；其他理工及非理工科系畢業者，需具機械相關乙級技術士證照(請檢附證明資料)。  2.具熱處理工作經驗1年(含)以上為佳(請檢附證明資料)。 | 1.碳鋼或鉻鉬鋼氣氛熱處理。  2.鋁合金與不銹鋼固溶、時效熱處理。  3.鈦合金與鎳基合金等真空熱處理。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  材料試驗  實作範圍：  材料熱處理程序及硬度測試  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業，其他理工及非理工科系畢業者，需具機械相關乙級技術士證照(請檢附證明資料)。  2.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：  (1)具機械相關工作經驗1年(含)以上。  (2)具機械類丙級(含)以上技術士證照。 | 可從事下列工作之一：  1.精密機械傳統車床加工作業。  2.光纖陀螺儀、機電陀螺儀等零件製作及組裝測試。  3.光纖繞製、熔接組裝，測試系統操作、信號檢測處理。  4.陀螺儀、加速儀現場組裝工作。  5.伺服閥、致冷器等精密零件製作。  6.伺服閥、致冷器等組裝測試。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  車床實作  實作範圍：  傳統車床車製加工  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 工業工程 | 1.機械/工業工程/資訊工程/生產管理等相關科系畢業。  2.具備下列資格條件為佳(請檢附證明資料)：  (1)具計畫管理/專案執行/機械設計繪圖/生產製造管理等相關工作經驗。  (2)具NET平台相關程式設計經驗。  (3)熟悉MS Office軟體操作或相關證照。  (4)可資佐證符合專長(技能)或工作內容之證明。 | 從事以下相關工作：  1.專案管理。  2.生產製造管理。  3.生產排程管制。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  Office軟體操作  實作範圍：  Word及Excel  軟體基本操作  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 化學/化工 | 1.化學(工)相關科系畢業；其他理工及非理工科系者，需具化學/化工相關乙級技術士證照(請檢附證明資料)。  2.具表面處理電鍍相關技術證照或工作經驗為佳(請檢附證明資料)。 | 表面處理電鍍作業。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  電鍍作業  實作範圍：  電鍍鎳實作  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 飛彈所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 化學/化工 | 1.化學（工）/材料等相關科系畢業；其他理工及非理工科系者，需具化學/化工相關乙級技術士證照(請檢附證明資料)。  2.具印刷電路板加工相關經驗為佳(請檢附證明資料)。 | 印刷電路板蝕刻、剝膜、剝錫及電鍍製作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  電路板影像轉移蝕刻製作  實作範圍：  電路板線路蝕刻及剝膜實作  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 化學/化工 | 1.化學/化工/材料等相關理工系所畢業。  2.具化學實驗設計與化學儀器操作/化學類產品生產製造或品質管理/化學分析實務或分析實驗室管理/儀器分析/高分子化學領域等工作經驗者為佳(請檢附相關工作經歷證明資料)。  3.具化學防護相關領域工作經驗者為佳(請檢附相關工作經歷證明資料)。  4.檢附以下證明文件供書面審查(報名時一併提供)：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文(全份)。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。  (5)英文能力檢定證明。  (6)國內外學術期刊發表及研討會論文。 | 1.化學製程規劃、試驗及化學防護裝備設計開發。  2.化學防護系統專案規劃、工程整合、計畫管理及整體後勤支援。  3.火工品相關製品開發/加工/研製/生產。  4.火炸藥、化學化工實驗、化學分析。  5.精密化學分析儀器實驗室管理。  6.推進劑、高分子材料開發應用、合成/改質、配方研究等相關工作。 | 9員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 化學/化工 | 1.化學/化學工程等相關理工系所畢業。  2.具化學有機合成或化學工程製程設計，曾執行相關研究等研發專案相關工作經驗者(需檢附相關工作經歷證明資料)。  3.檢附以下證明文件供書面審查(報名時一併提供)：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文(全份)。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。  (5)英文能力檢定證明。  (6)國內外學術期刊發表及研討會論文。 | 1.有機化學實驗設計與特用化學品開發等相關工作。  2.化工製程設計、生產製程規劃管理等相關工作。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 化學/化工 | 1.化學/化工/材料/紡織工程等相關理工系所畢業。  2.曾執行胚布組織、商用染助劑物性及化性變化研究相關工作經驗者為佳(請檢附相關工作經歷證明資料)。  3.檢附以下證明文件供書面審查(報名時一併提供)：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文(全份)。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。  (5)英文能力檢定證明。  (6)國內外學術期刊發表及研討會論文。 | 偽裝匿蹤材料開發與應用研究等相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 化學/化工 | 1.化學/化工/材料等相關理工系所畢業。  2.檢附以下證明文件供書面審查(報名時一併提供)：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文(全份)。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。  (5)英文能力檢定證明。  (6)國內外學術期刊發表及研討會論文。 | 推進劑藥柱、火工配方研發及製作等相關工作。 | 1員 | 屏東  滿州  及  高雄  大樹 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/光電/控制工程等相關理工系所畢業。  2.具網儀、頻譜及天線操作等相關工作經驗為佳(請檢附相關工作經歷證明資料)。  3.檢附以下證明文件供書面審查(報名時一併提供)：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文(全份)。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。  (5)英文能力檢定證明。  (6)國內外學術期刊發表及研討會論文。 | 電磁脈衝屏蔽防護材料開發與應用研究及驗證測試等相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電機/電子/航太等相關理工系所畢業。  2.具MCU(PIC、Arduino等)電路設計開發能力與經驗，熟悉C、Java、C++等開發程式。  3.具感測器電路(慣性、光學、電磁等)應用經驗為佳。  4.檢附以下證明文件供書面審查(報名時一併提供)：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文(全份)。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。  (5)英文能力檢定證明。  (6)國內外學術期刊發表及研討會論文。 | 武器系統安全備炸裝置之感測、邏輯演算、電路設計、韌體程式、火工組件等研究開發相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/物理/光電等相關理工系所畢業。  2.具備以下工作經驗或證照為佳(請檢附相關工作經歷證明資料)：  (1)類比電路設計開發。  (2)微波電路設計開發。  (3)FPGA Verilog 或VHDL程式開發。  (4)C/C++/C#/Java程式開發。  (5)Matlab/Labview程式開發。  (6)PLC程式控制開發。  3.檢附以下證明文件供書面審查(報名時一併提供)：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文(全份)。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。  (5)英文能力檢定證明。  (6)國內外學術期刊發表及研討會論文。 | 微波量測系統設計開發、電路設計、PLC程控軟體等研究開發相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1電子電機/機械/材料/自動控制等相關理工系所畢業。  2.具ISO 9001/品質工程師、技術師(CQE、CQT)等相關證照者為佳(請檢附相關證照或證書影本)。  3.檢附以下證明文件供書面審查(報名時一併提供)：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文(全份)。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。  (5)英文能力檢定證明。  (6)國內外學術期刊發表及研討會論文。 | 1.火工製藥程序、製程設備、儀電控制系統設計開發及維護等相關工作。  2.火工品質研發驗證、壽期工程、製程品管、等相關工作。 | 2員 | 高雄  大樹  及  屏東  滿州 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 資訊 | 1.理工相關系所畢業。  2.熟悉FORTRAN、C++、Java、VB、Python等程式語言。  3.對數學、物理、化學理論推導及程式逆向工程有興趣者。  4.檢附以下證明文件供書面審查(報名時一併提供)：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文(全份)。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。  (5)英文能力檢定證明。  (6)國內外學術期刊發表及研討會論文。 | 武裝系統終端效益分析、兵棋系統、建模及使用者介面研究與開發等相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械 | 1.機械相關理工系所畢業。  2.具雷射焊接等金屬封裝相關工作滿1年(含)以上，具3D電腦輔助繪圖證照為佳(請檢附證照/證書/工作經歷證明資料)。  3.檢附以下證明文件供書面審查(報名時一併提供)：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文(全份)。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考*試*資格、技術士技能檢定等相關證照。  (5)英文能力檢定證明。  (6)國內外學術期刊發表及研討會論文。 | 1.火工件設計  、分析模擬、繪圖製作、模具設計，雷射焊接封裝等相關工作。  2.火箭發動機生產製程設計、規劃執行等相關工作。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械 | 1.機械/土木/航空/應用力學/工業工程等相關理工系所畢業。  2.具自動控制、感測元件、馬達傳動、伺服機構設計、結構設計等工作經驗(需檢附相關工作經歷證明資料)。  3.具Solidworks等工程繪圖軟體相關證照者為佳。  4.具PLC或Arduino等控制器、Labview編譯平台為佳。  5.檢附以下證明文件供書面審查(報名時一併提供)：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文(全份)。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。  (5)英文能力檢定證明。  (6)國內外學術期刊發表及研討會論文。 | 1.火工品處理之人機分離機械裝備研製等相關工作。  2.化學防護裝備之通風過濾機組、氣體感應機組設計/製造/組測研究與開發等相關工作。  3.重型傳動機構設計/製造/組測研究與開發等相關工作。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械 | 1.機械/電機等相關理工系所畢業。  2.對從事機械檢定認證業務有興趣者，具機械、設備、器具之研究、設計、製造、安全檢查、測試或檢定業務者經驗者為佳(請檢附相關工作經歷證明資料)。  3.具ISO 9001或17025或17065等相關證照者為佳(請檢附相關證照或證書影本)。  4.檢附以下證明文件供書面審查(報名時一併提供)：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文(全份)。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。  (5)英文能力檢定證明。  (6)國內外學術期刊發表及研討會論文。 | 1.ISO產品、實驗室認證機構之建立、管理、推動與維持等相關工作。  2.火工研發驗證、壽期工程、製程品管、組裝稽核品質保證工程等相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 化學/化工 | 1.化學/化工/材料等相關科系畢業。  2.具有機溶劑或配方合成/化學分析/防蝕或表面處理/水質處理/化學反應實驗與製程架設相關工作經驗者為佳(請檢附相關工作經歷證明資料)。  3.具有化學/化工/環工相關專業證照為佳(請檢附相關證照影本)。 | 1.化學化工實驗、材料分析測試及生產製作與維護等相關工作。  2.精密化學分析儀器操作及維護等相關工作。  3.裝備防蝕及表面處理、熔射作業工作及技術開發等相關工作。  4.化學品材料開發，化工製程架設、維護與生產等相關工作。  5.化學防護偵檢技術開發。 | 9員 | 桃園  龍潭 | **筆試50%：**  普通化學  (60分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 化學/化工 | 1.理工相關科系畢業。  2.具火炸藥相關工作經驗者為佳。  3.如有以下證明文件報名時請一併檢附：  (1)專科(含)以上各學年成績單。  (2)從事化工或化學工作1年以上資歷證明。  (3)可資佐證符合專長或工作內容需求之證明、證照、文件等。 | 火工生產製作及測試等相關工作。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **筆試50%：**  普通化學  (60分合格)  **口試 50%**  (70分合格)) |
|  | 化學所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 化學/化工 | 1.化學/化工/材料等相關科系畢業。  2.具化學/化工丙級(含)以上技術士證照(需檢附證照影本)。  3.具毒化物管理專職人員證照為佳(請檢附證照影本)。  4.具化學/化工/粉體加工/煙火爆竹生產/化學分析/高分子化學領域/複合結構材料/化工廠物料管理及運儲相關工作經驗1年(含)以上者為佳(請檢附相關工作經歷證明資料)。  5.具「堆高機操作」技術士證或具98年9月1日以前操作結業證書/「固定式起重機操作-架空式-地面操作」技術士證或具100年7月1日以前操作結業證書者為佳(請檢附證照或證書影本)。 | 1.火工品、絕熱防火材料、特用化學品製作等實驗與製程相關工作。  2.化學品、毒化物、火工品庫儲管理等相關工作。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **筆試50%：**  普通化學  (60分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 化學/化工 | 1.化學/化工/材料等相關科系畢業。  2.至少符合下列資格條件之ㄧ者(需檢附相關工作經歷或受訓證明資料)：  (1)具噴漆、複材製作或化學品製作工作經驗為佳。  (2)具化工設備操作與維護相關工作經驗。  (3)具工廠操作1年以上實務經驗。  (4)具各公營機構有機或粉塵作業相關技能訓練證照或證明等為佳或其他可資佐證符合專長(技能)。  (5)具電磁波量測相關工作經驗。 | 吸波材料及各式泡棉生產製作、加工與檢測等相關工作。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **筆試50%：**  普通化學  (60分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 化學/化工 | 1.化學/化工等相關科系畢業。  2.具「堆高機操作」技術士證或具98年9月1日以前操作結業證書 為佳(請檢附證照或證書影本)。  3.具「固定式起重機操作-架空式-地面操作」技術士證或具100年7月1日以前操作結業證書為佳(請檢附證照或證書影本)。 | 火箭藥柱、彈頭裝藥生產製作及生產原料管理等相關工作。 | 3員 | 高雄  大樹  及  屏東  滿州 | **筆試50%：**  普通化學  (60分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 電子/電機 | 1.理工相關科系畢業。  2.具Solidworks等工程繪圖軟體相關證照者為佳(請檢附證照或證書影本)。  3.熟悉PLC或Arduino等控制器為佳。  4.具破壞性/非破壞性檢驗工作經驗1年(含)以上者為佳(請檢附相關工作經歷證明資料)。  5.具自動控制、感測元件、馬達傳動、機電整合產品組裝等工作經驗為佳(請檢附相關工作經歷證明資料)。  6.如有以下證明文件報名時請一併檢附：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)從事PLC可程式邏輯控制設計工作1年以上資歷證明。  (3)可資佐證符合專長或工作內容需求之證明、證照、文件等。 | 1.火工品生產製作、生產線操作維護等相關工作。  2.通風過濾機組、氣體感應機組製造/組測等相關工作。  3.破壞/非破壞性檢驗、機具操作等相關工作。  4.電機類設備操作、量測與電子設備操作維護等相關工作。  5.機械繪圖、設計等相關工作。 | 5員 | 桃園  龍潭 | **筆試50%：**  機電整合概念(60分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 電子/電機 | 1.電機/電子/航太相關科系畢業。  2.具電子電路設計與檢修能力、常用檢測儀器使用能力、電子元件線路板焊接、元件籌獲能力者為佳。  3.具電子電路相關工作經驗與證照者為佳(請檢附證照/證書/工作經歷證明資料)。  4.如有以下證明文件報名時請一併檢附：  (1)專科(含)以上各學年成績單。  (2)可資佐證符合專長或工作內容需求之證明、證照、文件等。 | 1.電子電路銲接、軟硬體模組組裝與測試。  2.電子電路元件籌獲、檢測與管理。  3.機電系統組裝。  4.參與引信電路研發測試相關試驗。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作50%：**  電路板錫焊  (60分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 電子/電機 | 1.理工相關科系畢業。  2.具以下工作經驗或證照為佳(請檢附相關證照或工作經歷證明資料)：  (1)具電子錫銲配線/模組組裝與測試相關工作經驗。  (2)具電機/電子儀表類技術士乙級證照。  (3)具射頻量測相關工作經驗。 | 1.電子錫銲、配線組裝、模組組裝與測試等相關工作。  2.吸波材料微波特性檢測作業等相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作50%：**  電路板錫焊  (60分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 電子/電機 | 1.電機/電子/自動控制等相關科系畢業。  2.具電機/電子訊號量測、電路板焊接、PLC控制邏輯相關工作經驗為佳(請檢附相關工作經歷證明資料)。  3.具以下條件者為佳(請檢附證照或證書影本)：  (1)具電機/電子儀表類技術士丙級(含)以上技術士證照。  (2)具「堆高機操作」技術士證或具98年9月1日以前操作結業證書。  (3)具「固定式起重機操作-架空式-地面操作」技術士證或具100年7月1日以前操作結業證書。 | 1.執行環境試驗、危害鑑定試驗、壽期驗證等試驗操作。  2.自然與動態環境試驗相關設備架設操作、試驗。 | 1員 | 屏東  滿州 | **實作50%：**  電路板錫焊  (60分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 電子/電機 | 1.不限科系畢業。  2.具非醫用輻射安全證書或曾接受36小時輻射安全防護訓練證明(需檢附相關證明影本)。  3.具「堆高機操作」技術士證或具98年9月1日以前操作結業證書(需檢附證照或證書影本)。  4.具「固定式起重機操作-架空式-地面操作」技術士證或具100年7月1日以前操作結業證書為佳(請檢附證照或證書影本)。 | 1.機械加工品  、材料等非破壞檢驗(為X光射線檢測)等相關工作。  2.品質紀錄、文件資料建立。  3.檢試報告製發等相關工作。 | 2員 | 高雄  大樹  及  屏東  滿州 | **實作50%：**  堆高機操作  (70分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 高中  (職)  畢業 | 30,000  |  37,000 | 機械 | 1.理工相關科系畢業。  2.具以下工作經驗或證照為佳(請檢附證照影本或工作經歷證明資料)：  (1)車床/銑床/鉗工/機械加工乙級(含)以上技術士證照。  (2)具機械相關工作經驗者。  (3)具「堆高機操作」技術士證或具98年9月1日以前操作結業證書者。  (4)具「固定式起重機操作-架空式-地面操作」技術士證或具100年7月1日以前操作結業證書。 | 執行化工製程金屬管件製作、加工與配置及化工機具維護等相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **筆試50%：**  機械概論  (60分及格)  **口試50%**  (70分及格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 機械 | 1.理工相關科系畢業。  2.具「堆高機操作」技術士證或具98年9月1日以前操作結業證書(需檢附證照或證書影本)。  3.具「固定式起重機操作-架空式-地面操作」技術士證或具100年7月1日以前操作結業證書為佳(請檢附證照或證書影本)。  4.具其他專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明文件為佳(請檢附相關證照/證書/工作經歷證明資料)。 | 1.火箭藥柱、彈頭裝藥等火工品生產製作、模具製作、製程控制等相關工作。  2.火工製程品管檢驗與測試等相關工作。 | 7員 | 高雄  大樹  及  屏東  滿州 | **實作50%：**  堆高機操作  (70分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 高中  (職)  畢業 | 30,000  |  37,000 | 機械 | 1.具「堆高機操作」技術士證或具98年9月1日以前操作結業證書(需檢附證照或證書影本)。  2.具「固定式起重機操作-架空式-地面操作」技術士證或具100年7月1日以前操作結業證書(需檢附證照或證書影本)。  3.具火工品銷毀相關工作經驗為佳(請檢附相關工作經歷證明資料)。 | 1.火工品製程組裝、拆卸等相關工作。  2.火工廢藥銷毀處理等相關工作。 | 3員 | 屏東  滿州 | **實作50%：**  堆高機操作  (70分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 高中  (職)  畢業 | 30,000  |  37,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業  2.具車床丙級(含)以上證照(需檢附證照影本)。  3.具車床工作經驗3年(含)以上(需檢附相關工作經歷證明資料)。  4.具火工相關工作實務經驗者為佳(請檢附相關工作經歷證明資料)。 | 火箭藥柱、彈頭裝藥等加工相關工作。 | 1員 | 屏東  滿州  及  高雄  大樹 | **實作50%：**  傳統車床  (70分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 駕駛 | 1.理工相關科系畢業。  2.具職業大貨車(含)以上駕照(需檢附證照影本)。  3.具「堆高機操作」技術士證或具98年9月1日以前操作結業證書(需檢附證照或證書影本)。  4.具「固定式起重機操作-架空式-地面操作」技術士證或具100年7月1日以前操作結業證書(需檢附證照或證書影本)。  5.具汽車修護乙級(含)以上技術士證照為佳(請檢附證照影本)。  6.具電子儀表類丙級(含)以上技術士相關證照為佳(請檢附相關證照影本)。 | 1.運輸(含火工)作業等相關工作。  2.車輛、動力機具等維護保養、管理等相關工作。 | 3員 | 高雄  大樹  及  屏東  滿州 | **實作50%：**  大貨車駕駛  (70分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 生產管理 | 1.不限科系畢業。  2.具生產管理技術相關證照者為佳。  3.具Excel及Word等Office軟體相關證照者為佳。  4.如有以下證明文件報名時請一併檢附：  (1)專科(含)以上各學年成績單。  (2)生產管理3年以上工作資歷證明。  (3)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 生產管理、工令管制、進度管控等相關工作。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **筆試50%：**  生產排程與管理(60分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 生產管理 | 1.不限科系畢業。  2.具Excel及Word等Office軟體相關證照者為佳。  3.具生產管理或採購之經驗或證照者為佳。  4.如有以下證明文件報名時請一併檢附：  (1)專科(含)以上各學年成績單。  (2)生產管理或採購3年以上工作資歷證明。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。 | 專案計畫供應商管理及技術能力認證等相關作業。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **筆試50%：**  採購與供應鏈管理  (60分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 化學所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 工業工程 | 1.不限科系畢業。  2.具以下工作經驗或證照為佳(請檢附相關工作經歷/證照/受訓證明)：  (1)MS Office軟體(含Project)操作相關證照。  (2)專案管理、生產管理、排程與進度管制、成本分析實務。  (3)ISO 2015品質系統維護及文件發行管理。  (4)職業安全衛生管理經驗或相關證照。 | 工作排程、進度管制、料件道次管理及品質系統維護等相關工作。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **筆試50%：**  工業工程概論(60分合格)  **口試 50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/資訊/控制/電信/通訊/資工/機械/動力機械等相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)微處理器/DSP應用電路開發與測試。  (2)數位電路設計與測試。  (3)光電轉換訊號放大/電源系統等類比電路開發。  (4)微處理器/DSP軔體程式開發及測試。  (5)熟FPGA Verilog 或VHDL硬體設計語言。  (6)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等影本。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。  (5)其它有助審查資料之文件。 | 1.微處理器/DSP應用電路開發與測試。  2.數位電路設計與測試。  3.光電轉換訊號放大/電源系統等類比電路開發。  4.微處理器/DSP軔體程式開發及測試。  5.熟FPGA Verilog 或VHDL硬體設計語言。 | 9員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 資訊/電子/電機 | 1.資訊/資工/電子/電機/控制/電信/通訊或其他相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)專研影像辨識,物件特徵比對與追蹤,自動辨識或深度學習演譯法。  (2)熟CCS、Linux、Windows  、RTOS、Matlab/SimuLink等任一作業環境，精通C/C++、Matlab或其他軟體語言。  (3)具備系統軟體設計能力者。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等影本。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。  (5)其它有助審查資料之文件。 | 1.專研影像辨識，物件特徵比對與追蹤,自動辨識或深度學習演譯法。  2.熟CCS、Linux、Windows、RTOS  、Matlab/ SimuLink  等任一作業環境，精通C/C++、Matlab或其他軟體語言。  3.具備系統軟體設計能力者。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 精密機械/光電機構/光學元件/光電量測 | 1.機械/動力機械/應力/控制/光電/物理/光學或其他相關理工系所畢業。  2.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)具光電機構設計相關工作經驗為佳。  (2)具結構及熱傳分析ANASY軟體，2D/3D SolidWorks繪圖軟體操作能力為佳。  (3)光學量測系統開發及檢修。  (4)光學元件設計/光路分析/光電系統整合。  (5)光路/機械整合模擬分析  (6)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文摘要、發表論文第一頁等影本。  (3)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。  (5)其它有助審查資料之文件。 | 1.具光電機構設計相關工作經驗為佳。  2.具結構及熱傳分析ANASY軟體，2D/3D SolidWorks繪圖軟體操作能力為佳。  3.光學量測系統開發及檢修。  4.光學元件設計/光路分析/光電系統整合。  5.光路/機械整合模擬分析 | 3員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 博士  畢業 | 75,000  |  85,000 | 光學成像系統 | 1.光電/物理/電機等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單與其它有助審查資料之文件(相關專業經驗、專題、論文)：  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)影像成像系統開發及設計。  (2)主動式光電影像系統設計及應用。  (3)成像光學系統設計分析。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。 | 1.光電影像系統開發。  2.主動式照明及低光度影像系統分析與應用。  3.半導體光源及影像系統整合。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 材料 | 1.材料/電子等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單與其它有助審查資料之文件(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)黃光微影製程。  (2)乾/濕式蝕刻、金屬蒸鍍等製程。  (3)元件特性量測。 | 執行半導體元件製程工作，包含：黃光微影製程、乾/濕式蝕刻、金屬蒸鍍等製程與元件特性量測工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 影像 | 1.電子/電機等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單與其它有助審查資料之文件(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)執行CMOS影像IC設計與測試。  (2)類比影像訊號及電路。  (3)數位影像訊號及電路。 | 執行CMOS影像IC設計與測試、類比影像訊號及電路、數位影像訊號及電路等。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 材料 | 1.光電/電機/機械等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單與其它有助審查資料之文件(相關專業經驗、專題、論文)  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)光電元件封裝技術。  (2)模組構型開發設計。  (3)光機電整合技術。 | 光電元件封裝技術、模組構型開發設計、光機電整合技術、機械設計等。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械 | 1.機械/應用力學/造船/航空/機電/複合材料等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單與其它有助審查資料之文件(相關專業經驗、專題、論文)  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明文件)：  (1)具力學模擬分析、Solidworks或 Catia設計相關軟體工作經驗。  (2)具機械/結構設計、振動與動態分析與量測相關工作經驗。  (3)具各式模治具設計開發相關工作經驗。  (4)具機械類加工製造、檢驗與品管工作經驗。  (5)曾執行複材結構設計、分析與製作開發等相關工作經驗。  (6)其他與工作內容所列項目相關經驗。 | 1.複合材料結構開發與研製。  2.複合材料製程設計開發。  3.複合材料結構設計分析與測試技術研究。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 材料 | 1.化工/材料/化學等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)陶瓷材料相關研發及測試工作。  (2)複合材料相關研發及生產工作。  (3)高分子材料研發及設計工作。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。 | 1.陶瓷及其複合材料研發。  2.材料改質與製程精進。 | 1員 | 新北三峽 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 博士  畢業 | 75,000  |  85,000 | 材料 | 1.材料/機械等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)金屬方向性凝固相關研發或製造。  (2)合金材料特性及相關製程開發。  (3)鑄造技術及製程開發。  (4)製造流程改善與管理、專案管理或專案助理相關經驗或證照者。  (5)其他與工作內容所列項目相關經驗。 | 1.鑄造技術及製程開發。  2.方向性凝固技術及製程開發。  3.製造流程與專案計畫管理。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 材料 | 1.材料/機械/化工等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)精密鑄造用陶瓷殼模與陶瓷型芯之檢驗與製造技術之研製。  (2)陶瓷材料之研究與製造技術開發。  (3)耐高溫塗層之研究與製造技術開發。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。 | 1.精密鑄造用陶瓷殼模與陶瓷型芯應用技術開發。  2.耐高溫塗層之研究與製造技術開發。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 博士  畢業 | 75,000  |  85,000 | 材料 | 1.材料/機械/化工材料等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具工作內容相關工作經驗3年以上(需檢附相關工作經歷證明)。  4.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)材料性質檢測分析。  (2)材料失效分析。  (3)逆向工程分析。  (4)特殊材料開發。  (5)其他與工作內容所列項目相關經驗。 | 1.材料性質檢測分析評估。  2.材料失效分析研判。  3.逆向工程分析。  4.特殊材料開發。  5.專案計畫管理。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 材料 | 1.材料相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)材料性質檢測分析。  (2)材料失效分析。  (3)逆向工程分析。  (4)特殊材料開發。  (5)其他與工作內容所列項目相關經驗。 | 1.材料性質檢測分析評估。  2.材料失效分析研判。  3.逆向工程分析。  4.特殊材料開發。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 品保 | 1.光電/電子/電機/資訊/機械/物理等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單與其它有助審查資料之文件(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照者為佳(請檢附相關證明文件)：  (1)熟悉品保工程、量測檢驗與測試驗證，並具品保及可靠度相關證照為佳。  (2)具產品環境工程/試驗/可靠度工程/試驗實務經驗。  (3)熟悉軟體品保規劃及驗證。  (4)ISO品質管理系統。  (5)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.品保規劃與製程品質管理及改善。  2.光電元件、模組與系統之品質檢驗/測試工程規劃與管制。  3.軟體品保工程及品保文件編撰。  4.光電元件及系統可靠度分析與壽期規劃及驗證。  5.光電系統自然環境試驗規劃與驗證 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 專案管理/生產管理/系統工程 | 1.理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級/托福iBT 72以上/TOEIC 800以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  4.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附證明資料)：  (1)系統工程/機電整合/機械設計等相關工作經驗者。  (2)具生產管理/物料管理相關工作經驗者。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗。 | 1.系統工程執行、量產進度、合約管理等相關管制及系統介面整合工作。  2.資源分配、時程管制、風險管理與流程改善***，***品質稽核等工作。  3.計畫執行外部合作商供應鏈制度建立與管理、計畫用料需求預測與外部供貨策略及作業研究最佳化分析。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械/電機 | 1.機械/電機/控制/動機/應力等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單與其它有助審查資料之文件(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關工作經歷證明)：  (1)具備自動控制、機構設計、載具動力學、動力系統、數值模擬等研究專長。  (2)其他與工作內容所列項目相關經驗。 | 1.砲塔武器控制系統設計、分析及整合測試。  2.執行砲塔武器系統開發、設計、測試、驗證與品質保證等系統工程等業務。  3.協辦砲塔武器結構設計。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/光電等相關科系畢業。  2.具電子/電機相關工作經驗1年以上(需檢附相關工作經歷證明)。  3.具備電子/電機相關之技術士執照或勞委會職訓局電子/電機相關訓練結訓為佳(請檢附相關證照影本)。 | 1.電路焊接及電路測試。  2.電路設計、佈局及控制程式編撰。  3.協辦物料採購及管理。  4.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)**實作30%：**  1.電子訊號量測  2.電子電路焊接  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機等相關科系畢業。  2.需檢附專科各學年成績單與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具相關工作經驗3年(含)以上(需檢附相關工作經歷證明)。  4.具以下工作經驗、條件或證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)具顯微鏡下精細作業等相關工作經驗。  (2)具電子/電機相關乙級證照。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗。 | 1.執行顯微鏡下精細組裝測試等相關工作。  2.執行玻璃成型等相關工作。  3.執行真空系統操作測試維護等相關工作。  4.執行環境試驗所需裝備測試等相關工作。  5.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)**實作30%：**  顯微精細作業  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 電子/電機 | 1.理工相關科系畢業。  2.需檢附大學各學年成績單與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件或證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)專案管理或專案助理相關經驗。  (2)孰悉Office Word、Excel、Powerpoint等相關作業軟體。  (3)有操作元件量測機台等相關經驗。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。 | 1.專案計畫管理。  2.計劃書編彙。  3.元件光電特性量測。  4.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  1.基礎光電元件量測  2.powerpoint  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 工業工程/資料處理 | 1.工業管理/資訊工程/資訊管理/資料處理等相關科系畢業。  2.需檢附大學各學年成績單與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件或證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)資料庫程式設計除錯。  (2)資料庫系統操作維護。  (3)ERP系統操作及開發、供應鍵管理。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。 | 1.數據處理。  2.資料庫程式編寫除錯。  3.資料建立、操作與維護。  4.資訊系統建置、操作及維護。  5.商源資訊管理。  6.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)**實作30%：**  資料庫程式編寫  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 影像 | 1.光電/機電等相關科系畢業。  2.需檢附專科各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.鉛作業特殊體格檢查合格(需檢附相關證明)。  4.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附證明資料)：  (1)1年(含)以上機電整合、光電量測、電路板檢測、接頭佈線等相關工作經驗為佳。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.執行光電模組製作及測試、線路配接、機台操作與維護工作。  2.影像電路板訊號檢修。  3.檢測裝備操作、示波器量測、訊號模擬與量測、電子設備檢修。  4.可配合輪班、  調班、出差。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)**實作30%：**  1.電子電路錫焊  2.線束接頭或示波器等儀器操作  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 材料 | 1.理工相關科系畢業。  2.需檢附大學各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)材料與機械加工。  (2)材料、製程、夾模治具開發。  (3)複合材料製程。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.複合材料製作與加工。  2.製程夾模治具設計與開發。  3.可配合輪班、  調班、出差。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)**實作30%：**  1.機械圖視圖  能力  2.車床加工  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 材料 | 1.理工相關科系畢業。  2.需檢附大學各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.有橡膠膠合成型或預浸料製作經驗尤佳。 (請檢附相關證明)：  (1)預浸料製作製程。  (2)複合材料製程。  (3)橡膠膠合、成型製程。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.軟質橡膠黏貼成型。  2.預浸料製作。  3.複合材料試片製作。  4.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)**實作30%：**  1.預浸料裁切  2.複合材料試片熱壓成型  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 機械 | 1.理工相關科系畢業。  2.需檢附專科各學年成績單與有助審查之相關資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件為佳(請檢附相關證明)：  (1)大型油壓機操作。  (2)電池相關製作經驗。  (3)模具加工設計。  (4)自動控制設計。 | 1.電池製作。  2.機械加工及機具維護。  3.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  Solidworks 工程製圖  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 材料 | 1.材料/機械/化工/電機/土木工程等相關科系畢業。  2.需檢附大學各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)機械加工機具操作及維護。  (2)大型機具如熱壓機等操作維護。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.複合材料製作。  2.機械加工及機具維護。  3.可配合輪班、  調班、出差。 | 4員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  1.機械圖視圖能力  2.按照施工圖執行預浸布裁切/疊貼、空壓機具操作能力  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 材料 | 1.理工相關科系畢業。  2.需檢附大學各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)非破壞檢驗  (2)材料機械性質測試  (3)工程製圖  (4)複合材料製程  (5)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.複合材料製作、檢驗、測試。  2.夾模治具設計/製圖。  3.生產管理。  4.可配合輪班、  調班、出差。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  1.材料機械性質試驗  2.Solidworks 工程製圖、按照施工圖執行預浸布裁切/疊貼  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 材料 | 1.理工相關科系畢業。  2.需檢附大學各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具複合材料或樹脂生產製造及測試等相關工作經驗為佳(需檢附相關工作經歷證明)。 | 1.複合材料及樹脂製造及測試。  2.複合材料及樹脂品質檢驗。  3.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  複合材料製造及測試實務  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 電子/電機 | 1.理工相關科系畢業。  2.需檢附大學各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)電子/電路/微波。  (2)有微波電性測試系統操作經驗、電路板實作。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.微波電性測試系統調校、操作。  2.微波測試件測試數據綜整、分析。  4.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 新北三峽 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加筆試及口試)  **筆試30%：**  電路學  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 材料 | 1.理工相關科系畢業。  2.具銲接、熱處理、硬銲、金屬加工製程相關工作經驗1年以上(需檢附相關工作經歷證明)。  3.具備銲接、熱處理、硬銲金屬加工製程之技術士執照或勞委會職訓局相關訓練結訓者為佳。(請檢附相關證照影本) | 1.雷射銲接及其它熔融銲接製程開發工作。  2.真空硬銲及真空熱處理製程開發工作。  3.陶瓷與金屬接合製程開發工作。  4.鋁合金熱處理製程開發工作。  5.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  金相試片製作  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 材料 | 1.機械/材料等相關科系畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)陶瓷材料相關研發及測試工作。  (2)複合材料相關研發及生產工作。  (3)RTM製程與工件表面處理。  (4)其他與工作內容所列項目相關經驗。 | 1.金屬/複材工件膠合、樹脂轉注成型、壓力釜成型等作業。  2.陶瓷複材工件光滑處理、噴漆等作業。  3.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 新北  三峽 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  樹脂轉注成型法概論  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 品保 | 1.理工相關科系畢業。  2.需檢附大學各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)具光電或材料產品品質檢測相關工作經驗。  (2)具有非破壞檢測(超音波、射線)檢測工作經驗。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.非破壞檢測之品質研判。  2.執行光電及材料件品保及品質檢測工作。  3.品質文件資料建立及品質系統驗證工作。  4.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加筆試及口試)  **筆試30%：**  品質管理概論  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 品保 | 1.理工相關科系畢業。  2.需檢附大學各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關證明)：  (1)電子零組件、光電系 統品保測試。  (2)具環境試驗之相關工作經驗。  (3)具備品保相關證照。  (4)具2年以上品保工程之相關工作經驗。 | 1.執行專案電子零組件、模組、光電系統等測試規劃及驗證  2.執行光電系統自然環境試驗及相關電性測試工作等。  3.執行各演訓任務裝備系統品保測試等相關工作。  4.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加筆試及口試)  **筆試30%：**  品質管理概論  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 專案管理 | 1.不限科系。  2.需檢附大學各學年成績單與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級/托福iBT 72以上/TOEIC 750以上及其它英文檢定證照同等級以上或英語系國家大學畢業學歷(需檢附證明資料)。  4.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附證明資料)：  (1)具專案管理/熟悉EXCEL操作等相關工作經驗者。  (2)產品行銷相關工作經驗者1年以上  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗。 | 1.專案計畫之管理。  2.國內外產品/技術展示行銷  3.協調科專計畫統籌規劃與建案等工作。  4.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作30%：**  EXCEL  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 專案管理 | 1.工業工程/工業管理/機械工程/光電工程/電機電子等相關理工系所畢業。  2.需檢附大學各學年成績單與其它有助審查資料之文件(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中高級/托福iBT 72以上/TOEIC 750以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  4.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附證明資料)：  (1)具專案管理/系統工程/生產管理/物料管理相關工作經驗者。  (2)具生產專案/物流管理系統實務經驗者。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗。  (4)熟悉Office Word、Excel、Powerpoint等相關作業軟體。  (5)熟悉國軍武獲程序且具軍事投資計畫建案經歷者。 | 1.執行專案計畫之管理、生產排程、進度管制、物料管理等相關工作。  2.時程管制、風險管理與流程改善，品質稽核等工作。  3.專案計畫書撰擬及管理計劃書編彙。  4.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加筆試及口試)  **筆試30%：**  國軍武獲程序及專案管理  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 專案管理 | 1.理工科系畢業。  2.需檢附大學各學年成績單與有助審查資料(相關證照、專業經驗、專題、論文)。  3.具以下工作經驗、條件、證照為佳(請檢附相關資料)：  (1)具生產專案規劃執行、時程管制、產品產製驗收等1年以上工作經驗。  (2)熟悉國軍武獲程序且具軍事投資計畫建案經歷者。  (3)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之相關審查資料(相關證照與經驗證明文件)。  (4)戰甲車操作維保、計管等作業。  (5)其他與工作內容所列項目相關經驗者。 | 1.專案建案及管理相關工作。  2.執行專案系統整合分析、軟硬體設計、系統整合測試、測評分析整合。  3.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加筆試及口試)  **筆試30%：**  國軍武獲程序及戰車概念  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 補給管理/採購管理 | 1.不限科系。  2.檢附大學各學年成績單。  3.具有全民英檢中高級/托福iBT 72以上/TOEIC 750以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  4.熟ORACLE資料庫或Access 軟體操作為佳。  5.具國內外民間採購經驗者尤佳。 | 1.料件籌購、商情分析、產業資料蒐整分析、購案作業、驗收結報等相關工作。  2.物料系統操作及物料管理等相關工作。  3.可配合輪班、  調班、出差。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加筆試及口試)  **筆試30%：**  撰寫購案指定廠商採購之評估報告  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 材電所 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 工安環保管理 | 1.需具勞動部職業安全衛生管理乙級技術士證照(請檢附證照影本)。  2.具有下列各項條件者為佳：  (1)曾從事工安承攬管理或工地管理相關工作1年以上經驗為佳(請檢附相關工作經歷證明)。  (2)具勞動部職業安全(衛生)管理甲級技術士證照(請檢附證照影本)。  (3)具環保相關證照(請檢附證照影本)。 | 1.執行承攬管理、工地巡檢與指導、職業安全衛生教育訓練及職業安全衛生文件管理。  2.擬訂、規劃及推動職業安全衛生、環保相關管理工作。  3.可配合輪班、  調班、出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (60分合格，合格者方可參加筆試及口試)  **筆試30%：**  職業安全衛生法及相關法規  (60分合格，合格者方可參加口試)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機等相關理工系所畢業。  2.具電子/電機相關工作經驗為佳(需檢附相關工作經歷證明)。  3.具「品管技術師」、「品保工程師」或「可靠度工程師」相關證照為佳(需檢附證照影本)。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.執行電子/電機產品品質保證管理。  2.執行電子/電機產品可靠度規劃評估與作業。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機等相關理工系所畢業。  2.具電子/電機相關工作經驗為佳(請檢附相關工作經歷證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.射控系統及飛彈介面整合及系統測試。  2.武器系統設計開發、功性能配當及電子系統開發。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 船舶工程 | 1.造船/機械等相關理工系所畢業。  2.具有船舶設計、船舶機械工程或裝艦工程等相關工作經驗1年以上(請檢附相關工作經歷證明)。  3.熟悉Matlab、Excel、Solidworks/AutoCAD等軟體工具為佳。  4.檢附以下證明文件供書面審查【(1)~(2)必備，(3)~(7)加分】：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文。  (3)國內外學術期刊發表論文紀錄。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (5)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (6)參加國、內外競賽獲獎證明。  (7)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.造艦規劃建案分析。  2.載台/裝備介面整合工程、裝備安裝測試評估。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機等相關理工系所畢業。  2.具有專案系統分析、設計或工程整合等相關工作1年以上經驗。  3.具軟硬體設計工作經驗為佳。  4.檢附以下證明文件供書面審查【(1)~(2)必備，(3)~(7)加分】：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文。  (3)國內外學術期刊發表論文紀錄。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (5)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (6)參加國、內外競賽獲獎證明。  (7)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.執行專案系統整合分析與軟硬體設計。  2.執行系統整合測試分析。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 造船/機械 | 1.造船/機械/材料/工程科學等相關理工系所畢業。  2.具有船舶設計/監造或模擬分析或系統工程整合或機構設計等相關工作經驗為佳(請檢附相關工作經歷證明)。  3.熟習Matlab、Excel VBA  、LabView、Solidworks  /AutoCAD等軟體工  具為佳。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.系統工程分析及模擬驗證。  2.工程介面整合與設計分析。  3.造艦規劃分析、載台/裝備介面整合工程、裝備安裝測試評估。  4.專案之生產規劃管理及進度管制。  5.系統整合測試及管理。  6.整體後勤規劃及工程管理。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/資工/資科等相關理工系所畢業。  2.具有系統工程、軟硬體設計工作、專案管理、工程整合、品保與後勤相關工作經驗(請檢附相關工作經歷證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.系統工程介面整合與設計分析。  2.系統組裝測試與部署。  3.導控系統設計分析及模擬測試等工作。  4.系統整合測試及工程介面管制等系統工程業務。  5.品管、品保、環境規格/試驗規劃、可靠度試驗與管理。  6.電子系統整合及測試管理工作。 | 4員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 博士  畢業 | 75,000  |  85,000 | 航太 | 1.航太/機械工程等相關理工系所畢業。  2.具備太空載具或衛星研發經驗為佳。  3.熟悉衛星任務分析與設計，軌道/推進分析與設計，曾執行相關研發專案具工作經驗3年(含)以上(請檢附相關工作經歷證明)。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩、博士論文及國內外學術期刊發表論文紀錄。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.太空任務分析與設計。  2.太空科技應用研發專案規劃與管理。  3.軌道/推進分析與設計。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 博士  畢業 | 75,000  |  85,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機工程相關學類理工系所畢業。  2.具備太空載具或衛星研發經驗為佳。  3.熟悉衛星任務分析與設計，太空電子/電機系統/次系統分析與設計，曾執行相關研發專案具工作經驗3年(含)以上(請檢附相關工作經歷證明)。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩、博士論文及國內外學術期刊發表論文紀錄。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.太空電子/電機系統/次系統分析與設計。  2.太空科技應用研發專案規劃與管理。  3.太空任務分析與設計。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 工業工程 | 1.工業工程等相關理工系所畢業。  2.具工業工程等相關工作經驗為佳。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.執行武器系統專案管理、生產管理、系統工程管理、品質管理等工作。  2.執行風險管理、物料管理、成本分析、作業研究等相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 雷達應用 | 1.電子/電機/太空科學等相關理工系所畢業。  2.曾參與執行雷達或微波系統相關研究計畫為佳(請檢附研究計畫內容、論著等相關經歷證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.雷達整合平台及校正系統研製。  2.固態雷達答應器研發規劃、設計及製造。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 雷達應用 | 1.電子/電機/太空科學等相關系所畢業。  2.曾參與執行雷達或微波系統相關研究計畫為佳(請檢附研究計畫內容、論著等相關經歷證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.測試場追蹤雷達系統穩定及可靠度精進。  2.配合測試操作雷達及GPS追蹤系統。  3.執行答應器測試及電子電路檢測、維修。 | 1員 | 屏東  滿州 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機等相關理工系所畢業。  2.須從事電子電路設計(FPGA或類比電路)、系統整合等相關工作1年以上。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.執行網路化之FPGA軟體設計及WINDOW人機介面開發相關工作。  2.執行類比電子電路設計及維修相關工作。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械 | 1.機械等相關理工系所畢業。  2.具備下列證照或經驗者為佳：  (1)具品保檢測或/與品質管理工作經驗(請檢附相關工作經歷證明)。  (2)具自動控制、機構設計、或冷凍空調等實務經驗(若有相關經驗，請檢附受訓記錄或工作經歷證明或相關成果資料)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.負責自然環境試驗督導與特性分析，及相關設備之籌建與維持。  2.負責動力環境試驗督導與特性分析，及相關設備之籌建與維持。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 系統整合 | 1.理工相關系所畢業。  2.曾執行車輛研發或生產相關專案管理、系統工程界面整合經驗為佳。  3.具備3D車輛工程設計繪圖能力為佳。  4.具備結構應力、應變分析與審查能力為佳。  5.具英語聽、說、讀、寫中級檢定以上為佳。  6.曾從事產品美學設計經驗為佳。  7.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.機動式武器系統車輛工程整合設計、研發量產、專案管理(設計、製造、試驗及生產等)。  2.車輛工程關鍵技術評估、零件設計/製造/組測構型管制、系統偵錯肇因分析、風險管理、採購籌補及專案管理等專案工作推動執行。  3.車輛外型美學設計。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 物理 | 1.物理等相關理工系所畢業。  2.具C++/C#語言程式開發經驗。  3.具備電腦兵棋或作戰效益模擬系統開發及運用經驗（有相關證照為佳）。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.作戰效益模擬分析運用及模式開發。  2.電腦兵棋模擬運用及系統開發。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 博士  畢業 | 75,000  |  85,000 | 工業工程 | 1.工業工程等相關理工系所畢業。  2.具以下條件之一為佳(請檢附相關工作經歷證明)：  (1)具備系統人因工程評估相關工作經驗為佳。  (2)熟悉人因工程測試與評估，曾執行相關人機介面設計、人因工程實驗評估、人為失誤、噪音音響評估(含震動)、系統工程等研發專案相關工作經驗者(需檢附相關工作經歷證明)。  (3)具備人因工程認證相關工作經驗為佳。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.武器系統人因工程規範研究、建案。  2.專案人因工程設計規劃、量測及測試評估、統計分析等作業。  3.使用者行為大數據分析。  4.產品人因工程實驗室認證。  5.執行人因工程風險數據資料量測、分析及處理。  6.陣地人因工程設計、規劃與評估。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 工業工程 | 1.工業工程相關理工系所畢業。  2.具備系統人因工程設計評估、優使性介面程式撰寫相關工作經驗為佳。  3.具備人因性危害預防、量測分析與評估實際工作經歷(如TOSHMS內部稽核人員)相關證照。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.專案人因工程設計、測試評估、人因統計分析。  2.肌肉骨骼傷害、人為可靠度與系統安全。  3.產品人因工程實驗室認證。  4.人體計測調查。  5.人因工程資料庫建置。  6.實驗設計規劃與執行。  7.陣地及大型系統人因工程量測。 | 4員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 工業工程 | 1.工業工程/機械/工程科學等相關理工系所畢業。  2.具有模擬分析或系統工程整合或機構設計等相關工作經驗為佳(請檢附相關工作經歷證明)。  3.熟習Matlab、Excel VBA  、LabView、Solidworks  /AutoCAD等軟體工  具為佳。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.機械/電子系統產品之品管、品保、品質管理、統計分析、可靠度工作。  2.生產管理、物料管理、後勤管理、產品資訊管理。  3.執行專案管理，計畫管制，進度管制。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 資訊 | 1.資工/資科/電子/電機等相關理工系所畢業。  2.具有系統工程、軟硬體設計工作、專案管理、工程整合、品保與後勤相關工作經驗為佳(請檢附相關工作經歷證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.程式開發設計及軟體工程。  2.軟體構型管理規劃及執行。  3.專案知識管理系統及流程化工具開發與導入。  4.資料庫軟體程式開發規劃及管理。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 心理 | 1.心理相關理工系所畢業。  2.具備認知心理、心智負荷、行為觀察等相關實務經驗為佳。  3.具備優使性介面設計評估或程式撰寫相關實務經驗。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.大型系統人員心智負荷、情境察覺、認知能力與人為失誤預測評估。  2.使用者行為研究分析與資料庫建置。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 資工 | 1.資工相關系所畢業。  2.具備系統人機互動介面程式撰寫相關工作經驗為佳。  3.具備人機系統程式語言規劃撰寫/資料庫(前/後端)系統建置維護/大數據分析實務。  4.檢附以下證明文件供書面審查：：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄及碩士論文題目(含摘要)。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (4)托福或多益或全民英檢中高級成績證明。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.人機互動介面程式編撰、使用者介面設計。  2.人因工程資料庫前/後端系統建置維護。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 工業工程 | 1.機械/電子/電機/資訊/工業工程等相關科系畢業。  2.具機械設計、工程設計、分析與測試相關工作經驗為佳(請檢附相關工作經歷證明)。  3.熟習Excel VBA、Solidworks/Auto CAD等軟體工具為佳。  4.檢附以下證明文件供書面審查為佳：  (1)大學各學年成績單。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明等。 | 1.產品解繳驗收、整體後勤支援等相關工作。  2.生產管理、物料管理、後勤管理等相關工作。  3.品質系統管理相關工作。  4.專案管理執行協調相關工作。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **實作60%:**  Microsoft  Office鑑測  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 電子/電機 | 1.理/工相關科系畢業。  2.檢附以下證明文件供書面審查為佳：  (1)大學各學年成績單。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明等。 | 1.測試場追蹤雷達操作及工作站各項裝備維護及保養。  2.執行電子電路檢測、維修及元件更換。 | 1員 | 綠島 | **實作60%：**  電子電路實測及  電子儀錶操作  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 通信 | 1.電機/電子/通信/資訊等相關科系畢業。  2.檢附以下證明文件供書面審查為佳：  (1)大學各學年成績單。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明等。 | 1.數位微波、光纖等通信系統維護與操作。  2.網路系統管理及電子電路檢修與製作。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  儀表操作與通信線材製作  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 通信 | 1.電機/電子/通信/資訊等相關科系畢業。  2.檢附以下證明文件供書面審查為佳：  (1)大學各學年成績單。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明等。 | 1.數位微波、光纖等通信系統維護與操作。  2.網路系統管理及電子電路檢修與製作。 | 1員 | 屏東  滿州 | **實作60%：**  儀表操作與通信線材製作  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/資訊等相關科系畢業。  2.具聯結車、大貨車駕駛執照為佳(請檢附駕照影本)。  3.至少符合下列資格條件之ㄧ(請提供證明列為書面審查評分)：  (1)具電子/電機/資訊類相關工作經驗2年(含)以上。  (2)具電子/電機/資訊類相關技術士技能證照。  4.檢附以下證明文件供書面審查為佳：  (1)大學各學年成績單。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明等。 | 1.光學暨雷達相關追蹤系統(含儀俱車)操作與養護。  2.視訊相關系統(含高速攝影、紅外線熱像儀、微波通訊、顯控整合)操作與養護。 | 2員 | 屏東  滿州 | **筆試60%：**  基本電學  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 資訊 | 1.電子/資訊/傳播等相關科系畢業。  2.至少符合下列資格條件之ㄧ(請提供證明列為書面審查評分)：  (1)具電子/資訊/傳播類相關工作經驗2年(含)以上。  (2)具電子/資訊/傳播類相關技術士技能證照。  3.檢附以下證明文件供書面審查為佳：  (1)大學各學年成績單。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明等。 | 1.專業攝影及器材維護。  2.視訊剪輯及特效製作。  3.須可配合工作至外地公差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作60%：**  攝影與後製  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業。  2.具固定起重機及堆高機相關技術士技能證照(須檢附相關證照證明)。  3.具小客車、大貨車駕駛執照或車床、銑床相關證照為佳(請檢附相關證照影本)。  4.檢附以下證明文件供書面審查為佳：  (1)大學各學年成績單。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明等。 | 負責測試場起重機/堆高機及機械裝備之操作與維護。 | 1員 | 屏東  滿州 | **實作60%：**  裝備操作  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機等相關科系畢業。  2.具小客車、大貨車或固定起重機及堆高機技能證照為佳(請檢附相關證照影本)。  3.檢附以下證明文件供書面審查為佳：  (1)大學各學年成績單。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明等。 | 1.各項電子裝備之操作與維護。  2.執行電子電路檢測、維修及元件更換。 | 1員 | 屏東  滿州 | **筆試60%：**  電力電子、  基本電學  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 工業工程管理 | 1.理/工相關科系畢業。  2.具工業工程管理相關工作經驗為佳(請檢附相關工作經歷證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查為佳：  (1)大學各學年成績單。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明等。 | 1.專案管理及測試任務規劃。  2.測試場飛試航管規劃、申請及管制作業。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **筆試60%：**  專案管理  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機相關科系畢業。  2.具電子/電機相關工作經驗為佳(請檢附相關工作經歷證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查為佳：  (1)大學各學年成績單。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明等。 | 1.執行電路製作及訊號量測、佈線、系統測試。  2.執行各演訓遙測任務等相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **筆試60%：**  遙測硬品實作鑑測(電路、佈線、接頭)  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 機械 | 1.機械等相關科系畢業，其他理工及非理工科系，需具機械相關乙級技術士證照。  2.具備下列證照或經驗者為佳：  (1)從事等機械加工或冷凍空調等相關工作1年(含)以上經驗(請檢附相關工作經歷證明)。  (2)具備冷凍空調等相關丙級技術士證照 (需檢附證照影本)。  3.檢附以下證明文件供書面審查為佳：  (1)大學各學年成績單。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明等。 | 1.執行各類硬品環境試驗，包括溫度、濕度、振動、衝擊等試驗。  2.執行自然環境試驗設備維修保養及試驗。  3.配合執行自然環境試驗夜間輪班工作。  4.執行各環境試驗資料量測及處理。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **筆試60%：**  機械設計與冷凍空調概論  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 工學設計 | 1.設計相關科系畢業。  2.檢附個人設計相關作品集。  3.具以下工作經歷之一者為佳(請檢附相關工作經歷證明或證照影本)：  (1)互動介面優使性設計實務經驗。  (2)產品外觀感性工學設計。  (3)熟悉CAD、U3D、C4D等軟體操作。  (4)國內外設計競賽相關作品。  4.檢附以下證明文件供書面審查為佳：  (1)大學各學年成績單。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明等。 | 1.武器系統人機互動介面優使性設計。  2.感性工學設計。  3.電腦化教學系統3D維護。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **書面審查30%**  (70分合格)  **筆試30%：**  使用者介面設計、色彩學、數位媒體設計、感性設計(任選二門)  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 技術類 | 高中職  畢業 | 30,000  |  37,000 | 電(工)機 | 1.電(工)機相關科系高(中)職畢業。  2.具乙級(含)以上電機技術士證照(室內配線或工業配線，需檢附證照影本)。  3.具水電或發電機維修等相關工作經驗1年(含)以上為佳。  4.檢附以下證明文件供書面審查為佳：  (1)高職各學年成績單。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明等。 | 1.館舍及設施水電、空調系統建置及維護等相關工作。  2.需配合工作需求輪值。 | 2員 | 屏東  滿州 | **實作60%：**  電路配線  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 電機 | 1.資訊/電機/電子/通訊等相關科系畢業。  2.具以下工作經驗或證照為佳(請檢附相關證明或證照影本)：  (1)具備通信裝備及弱電系統操作保修等相關工作經驗。  (2)具資通訊工作經驗1年(含)以上(需檢附相關工作經歷證明)。  3.檢附以下證明文件供書面審查為佳：  (1)專科各學年成績單。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明等。 | 1.有線電話、電視線路/網路線路架設維修。  2.資訊機房設備維護及指令操作設定。 | 2員 | 屏東  滿州 | **實作60%：**  接線製作  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系發  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機/資訊工程相關科系畢業。  2.具工程設計、分析與測試相關工作經驗為佳。(請檢附相關工作經歷證明)。  3.熟習Excel VBA、Solidworks/ AutoCAD等軟體工具為佳。  4.檢附以下證明文件供書面審查為佳：：  (1)大學各學年成績單。  (2)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明等。 | 1.執行工程測試、精密電子零組件檢驗及品質統計等相關工作。  2.專案管理執行協調相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **實作60%**  Microsoft Office鑑測  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系維  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 儀器校正 | 1.機械相關理工系所畢業。  2.檢附以下證明文件、工作經歷供書面審查評分參考：  (1)大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)。  (2)國內外學術期刊、論文發表文件及其他有助於審查文件(專題、研究報告)。  (3)英文檢定(托福、多益或全民英檢等)成績證明。  (4)具儀器校正、品保、設計、製造、量測、維修相關工作經歷為佳(請檢附相關工作經歷證明)。  (5)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明影本。 | 執行機械領域(角度、長度、流量、壓力、力量、質量、溫濕度等)之校正與現場遊校，以及校正系統研究評估與TAF認證等相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系維  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 儀器校正 | 1.電子相關理工系所畢業。  2.檢附以下證明文件、工作 經歷供書面審查評分參考：  (1)大學及研究所各學年成績單。(成績單未檢附者視為資格不符)  (2)國內外學術期刊、論文發表文件及其他有助於審查文件(專題、研究報告)。  (3)英文檢定(托福、多益或全民英檢等)成績證明。  (4)具儀器校正、品保、設計、製造、量測、維修相關工作經歷者為佳(請檢附相關工作經歷證明)。  (5)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明影本。 | 執行電子電量領域(電壓、電流、電阻、頻率等)之儀器校正與現場遊校，以及校正系統研究評估與TAF認證等相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系維  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 工業工程/電子/電機 | 1.工業工程/電子/電機等相關理工系所畢業。  2.具維修工程及專案管理相關分析及規劃作業相關工作經歷為佳(若有經驗，請檢附相關工作經歷證明、作品)。  3.檢附以下證明文件供書面審查:  (1)檢附碩士班各學年成績單及畢業證書。  (2)碩士論文或國內外學術期刊發表論文紀錄。  (3)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之得獎獎狀或公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.執行電子/電機/電力系統裝備維修專案管理。  2.執行系統後續維持工程專案分析規劃及管理。  3.可配合出差。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系維  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 資訊工程 | 1.資訊相關理工系所畢業。  2.熟悉Web開發相關技術(HTML、JavaScript、jQuery、AJAX、CSS、SQL)，曾執行網站建置及管理、資料庫應用及維護、系統架構規劃、系統整合分析等專案相關工作經驗2年(含)以上(請檢附相關工作經歷證明)。  3.具備IIS管理、ASP.NET  、PL/SQL Stored Procedure開發經驗佳(可檢附相關證照或作品或心得)。  4.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文。  (3)可資佐證符合專長(技能)、工作內容或具開發經驗之證明文件。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。 | 1.IIS建置及管理。  2.料號資訊系統(Web)開發、設計及維護(C#、Crystal Report、CSS、JavaScript)。  3.料號資料庫(PL/SQL)預存程序開發及維護。  4.Bootstrap、Foundation等RWD技術導入。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系維  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 資工/電機 | 1.資工、電機等相關理工系所畢業。  2.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)具產品開發設計等相關工作經驗(如:軟體開發、專案管理)為佳(請檢附相關工作經歷證明、作品)。  (2)大學(含)以上各學年成績單。  (3)國內外學術期刊、論文發表文件。  (4)托福、多益或全民英檢成績證明。 | 1.執行產品開發軟體系統安全分析、危害分析與評估、危害風險管理等工作。  2.執行系統安全故障樹模式建立、分析與評估。  3.執行系統安全資料庫開發工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查50%**  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系維  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 儀器校正 | 1.機械相關科系畢業。  2.檢附以下證明文件、工作經歷供書面審查評分參考：  (1)大學各學年成績單 (未檢附者，視同資格不符)。  (2)具儀器校正、品保、設計、製造、量測、維修相關工作經歷為佳(請檢附相關工作經歷證明)。  (3)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明影本。 | 執行機械物理領域(壓力、角度、長度、流量、力量、質量、溫濕度等)之校正與現場遊校等相關工作。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **實作50%：**  儀器校正  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 系維  中心 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 後勤維修 | 1.電子/電機/機械類 等相關科系畢業。  2.具設備維修/保養經驗或相關維修/保養資料蒐集與建置作業經驗為佳(請檢附相關工作經歷)。 | 1.執行武器系統維修/保養作業。  2.執行武器系統維修/保養資料蒐集與建置作業。 | 1員 | 桃園  龍潭  (視維修需求，  需配合長期派駐維修地點。) | **筆試60%**  電子學  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系製  中心 | 研發類 | 博士  畢業 | 75,000  |  85,000 | 機械 | 1.機械相關理工系所畢業。  2.具機械設計、自動化設計與結構分析等相關工作經驗為佳(請檢附工作經歷證明文件)。  3.請檢附以下證明文件供書面審查：  (1)檢附大學及研究所各學年成績單。  (2)博士論文。  (3)其它有助審查及可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明資料，例如：國內、外學術期刊發表論文；國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本；托福或多益或全民英檢中高級成績證明影本；參加國、內外競賽獲獎證明；其他公、民營機構訓練證照或證明影本。 | 1.執行自動化及智能化生產線設計與配置。  2.執行自動化進料或生產機構、各式工模夾治具設計與結構分析。 | 1員 | 新北市  三峽 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系製  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 機械 | 1.機械相關理工系所畢業。  2.具機械設計、自動化設計與結構分析等相關工作經驗為佳(請檢附工作經歷證明文件)。  3.請檢附以下證明文件供書面審查：  (1)檢附大學及研究所各學年成績單。  (2)碩士論文。  (3)其它有助審查及可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明資料，例如：國內、外學術期刊發表論文；國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本；托福或多益或全民英檢中高級成績證明影本；參加國、內外競賽獲獎證明；其他公、民營機構訓練證照或證明影本。 | 1.執行自動化及智能化生產線設計與配置。  2.執行自動化進料或生產機構、各式工模夾治具設計與結構分析。 | 3員 | 新北市  三峽 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系製  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機等相關理工系所畢業。  2.具以下工作技術經驗之一為佳(請檢附證明資料)：  (1)嵌入式硬體系統整合。  (2)FPGA/CPLD系統晶片設計。  (3)C/C++系統程式開發。  (4)Linux系統軟體開發。  3.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。 | 1.嵌入式硬體系統整合  2.FPGA晶片設計。 | 1員 | 新北市  三峽 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系製  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 物理/數學 | 1.物理/數學等相關理工系所畢業。  2.具以下專長或工作經驗者  為佳(請檢附相關證明)：  (1)C/C++程式開發。  (2)GTK程式開發。  (3)Linux系統軟體程式開發。  (4)演算法分析與設計。  (5)軟體工程與網路工程。  (6)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附以下證明文件供書面審查(未檢附者，該項不予給分)：  (1)大學及碩士歷年成績單與論著。  (2)國內外學術期刊發表論文紀錄。  (3)參加國、內外競賽獲獎證明。  (4)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明文件。 | 1.彈道解算及相關演算法分析與設計。  2.射控系統軟硬體設計與應用及相關技術之研究。  3.射控系統軟體程式開發與測試。  4.執行武器系統安裝與測試作業。 | 2員 | 新北市  三峽 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 系製  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 機械 | 1.機械相關科系畢業。  2.具CNC銑床或CNC車床操作乙級(含)以上證照(需檢附證照影本)。  3.具CNC銑床或CNC車床工作經驗1年(含)以上(需檢附相關工作經歷證明)。 | 1.飛彈火箭大型機械零件加工、複材零件CNC銑床加工、精密齒輪加工或各式機械零件水刀切割加工。  2.機械模夾治具加工。  3.需配合工作任務執行夜間輪班作業。 | 3員 | 新北市  三峽 | **實作60%：**  CNC銑床或CNC車床  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系製  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 資工 | 1.資工相關理工科系畢業。  2.具備資訊工程相關工作經驗。  3.請檢附大學各學年成績單(若有碩士學歷請一併檢附)。如有下列文件，請於報名時一併提供審查：  (1)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (2)參加國、內外競賽獲獎證明。  (3)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.協助射控系統硬體或電路設計。  2.協助射控系統軟體程式開發與測試。  3.Linux系統核心程式開發。  4.執行武器系統安裝、測試及部署作業。  5.需配合工作任務執行夜間輪班作業。 | 2員 | 新北市  三峽 | **書面審查20%**  (70分合格)  **筆試30%：**  計算機結構  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 系製  中心 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 機械 | 1.領有身心障礙手冊(證明)人員(需檢附證明資料)。  2.理工相關科系畢業。  3.熟稔solidworks或solidedge 操作。  4.熟悉結構/機構相關加工經驗為佳。  5.檢附以下證明文件供書面審查：  (1)專科各學年成績單(若有大學以上學歷請一併檢附)。  (2)可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之證明。  (3)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照。 | 1.各式工模夾具設計繪製。  2.系統設計與繪製。 | 1員 | 新北市  三峽 | **書面審查20%**  (70分合格)  **實作30%：**  Solid Edge或Solid Work  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 系製  中心 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 品保工程 | 1.理工相關科系畢業。  2.熟悉ISO 9001品質管理系統、品保工程、品質管制手法及量測檢驗等(需檢附相關證明)。  3.具1年(含)以上品質管理(制)、品保工程等相關工作經驗(需檢附工作證明，具品保相關證照及三次元量床操作經驗為佳)。 | 1.執行產品組裝品保規劃、相關測試與管制工作。  2.品質管理規劃與製程品質管理、量測檢驗/測試工程規劃與管制。  3.需配合工作任務執行夜間輪班作業。 | 1員 | 新北市  三峽 | **書面審查20%**  (70分合格)  **實作30%：**  機械尺碼量測實作  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 系製  中心 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 電子/電機 | 1.機電相關科系畢業。  2.具工作內容所列項目相關經驗優先(請檢附相關證明)。  3.具錫銲相關證照者優先(請檢附證照影本)。  4.檢附專科各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)；若有大學以上成績單請一併檢附。 | 1.系統組裝及測試。  2.需配合工作任務執行夜間輪班作業。 | 6員 | 新北市  三峽 | **實作60%：**  錫焊  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系製  中心 | 技術類 | 高中職  畢業 | 30,000  |  37,000 | 化工 | 曾從事噴塗相關工作1年以上(請檢附相關工作經歷證明資料)。 | 1.各類軍品噴塗與組裝。  2.侷限空間內部噴塗。  3.支援各類產品生產任務。  4.需配合工作任務執行夜間輪班作業。 | 2員 | 新北市  三峽 | **實作60%：**  調漆與噴塗  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系製  中心 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 物料管理 | 1.具倉儲管理相關證照為佳(需檢附相關證照影本)。  2.具經中央主管機關認可之「堆高機」操作人員資格為佳(請檢附相關證明)。  3.具物料管理或物流管理等相關工作經驗1年以上為佳(請檢附相關工作經歷證明資料)。 | 1.貨物、清點盤存作業。  2.料件入庫、撥發等相關工作。  3.庫儲料件盤點。  4.操作移動式堆高機搬運料件入出庫。  5.需配合工作任務執行夜間輪班作業。 | 1員 | 新北市  三峽 | **書面審查20%**  (70分合格)  **實作40%：**  操作移動式堆高機搬運棧板放置指定位置及使用電子秤秤重計數量，  二項實作各20%  (70分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 系製  中心 | 技術類 | 專科  畢業 | 35,000  |  42,000 | 電子/電機 | 1.電子/電機等相關科系畢業。  2.請檢附以下任一或多項工作經驗證明，供書面審查評分：  (1)具乙級(含)以上電機技術士證照(室內配線或工業配線，需檢附證照影本)。  (2)具水電或發電機維修等相關工作經驗1年(含)以上為佳。  (3)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之相關審查資料(相關證照與經驗證明文件)。 | 1.館舍及設施水電、空調系統建置及維護等相關工作。  2.需配合工作任務執行夜間輪班作業。 | 1員 | 新北市  三峽 | **書面審查20%**  (70分合格)  **實作30%：**  電路配線  (70分合格)  **口試50%**  (70分合格) |
|  | 資管  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 資訊/  工業工程  (管理) | 1.理工相關學院碩士畢業，非理工學院頒發學位者，至少應修滿相關理工學分3分之2以上，其畢業論文內容有積極相關性。  2.以資訊管理/工業工程(管理)/管理科學/科技管理等相關系所畢業為佳。  3.熟悉專案管理、營運管理、系統分析、國防科技研發與計畫作為等相關理論與實務為佳(請檢附相關證明)。  4.曾從事相關專案管理、營運管理、經營企劃等相關工作為佳(請檢附相關工作經歷證明)。  5.請檢附下列資料供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內、外學術期刊發表(相關)論文紀錄。  (3)具專案管理或理工技術職類相關證照。  (4)全民英檢中級(或相當於多益550分；托福筆試457分/電腦測驗137分/網路測驗47分)，或曾於英語系國家進修並獲碩士學位。 | 專案管理、營運管理及系統分析規劃。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 資管  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 資訊管理/科技管理/工業工程  (管理) | 1.理工相關學院碩士畢業，非理工學院頒發學位者，至少應修滿相關理工學分3分之2以上，其畢業論文內容有積極相關性。  2.以資訊管理/科技管理/工業工程(管理) 等相關系所畢業為佳。  3.熟悉專案管理、營運規劃管理、ERP、資源管理整合、資訊系統分析等相關理論與實務為佳(請檢附相關證明)。  4.曾從事相關專案管理  、營運規劃管理、資源管理整合、採購及物料運籌等相關工作為佳(請檢附相關工作經歷證明)。  5.請檢附下列資料供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)國內、外學術期刊發表(相關)論文紀錄。  (3)具專案管理、採購及物料運籌、資通科技或理工技術職類相關證照。  (4)全民英檢中級(或相當於多益550分；托福筆試457分/電腦測驗137分/網路測驗47分)，或曾於英語系國家進修並獲碩士學位。 | 專案管理、營運管理、ERP、資源管理整合、資訊系統分析。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 資管  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機/資訊 | 1.理工相關學院碩士畢業，非理工學院頒發學位者，至少應修滿相關理工學分3分之2以上，其畢業論文內容有積極相關性。  2.以電子/電機/資訊等相關系所畢業為佳。  3.具備網路作業環境維運管理、虛擬化平台維運或資訊作業環境維運管理相關經驗為佳。  4.經歷加分項目(請檢附相關證明)：  (1)相關工作經歷證明。  (2)網路作業環境維運管理、虛擬化平台維運或資訊作業環境維運管理經驗之相關證明。  (3)國內、外學術期刊發表(相關)論文紀錄。  (4)具專案管理或理工技術職類相關證照。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。  (7)全民英檢中級(或相當於多益550分；托福筆試457分/電腦測驗137分/網路測驗47分)，或曾於英語系國家進修並獲碩士學位。 | 1.資訊作業環境及資訊機房規劃、設計、建置、維管。  2.資料庫管理系統規劃、設計、建置、維管。  3.電子郵件規劃、設計、建置、維管。  4.本院雲端系統及虛擬化平台(VMware、Citrix、Hyper-V)規劃、設計、建置、維管。  5.視訊系統規劃、設計、建置、維管。  6.本院網路設計、規劃、維運。 | 4員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 資管  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機/資訊 | 1.理工相關學院碩士畢業，非理工學院頒發學位者，至少應修滿相關理工學分3分之2以上，其畢業論文內容有積極相關性。  2.以電子/電機/資訊等相關理工系所畢業為佳。  3.具備網路系統專案規劃管理或網路作業環境維運管理相關經驗為佳(請檢附相關證明，納入書面審查加分項目)。  4.請檢附下列資料供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單及畢業證書影本。  (2)國內、外學術期刊發表(相關)論文紀錄。  (3)具專案管理或理工技術職類相關證照。  (4)參加國、內外競賽獲獎證明。  (5)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。  (6)全民英檢中級(或相當於多益550分；托福筆試457分/電腦測驗137分/網路測驗47分)，或曾於英語系國家進修並獲碩士學位。 | 1.通信作業環境及通信機房規劃、設計、建置、維管。  2.通信安全監控及安全防護規劃、設計、建置、維管。  3.通信系統規劃、設計、建置、維管。  4.通信管道(線)管理。  5.視訊系統規劃、設計、建置、維管。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 資管  中心 | 研發類 | 博士  畢業 | 75,000  |  85,000 | 資訊/資管 | 1.資訊/資管相關理工系所畢業。  2.2年(含)以上相關工作經驗(請檢附相關工作經歷證明)。  3.經歷加分項目(請檢附相關證明)：  (1)資料融合演算法開發之相關工作經驗。  (2)無線通訊模組之相關工作經驗。  (3)智能自動化模組開發之相關工作經驗。  (4)全民英檢中級(或相當於多益550分；托福筆試457分/電腦測驗137分/網路測驗47分)。 | 1.分散式資料處理演算法之開發、驗證與實作。  2.分散式通訊模組之開發驗證與實作。  3.智能自動化系統之開發、驗證與實作 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 資管  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 資訊/電子/電機 | 1.資訊/電子/電機等相關理工系所畢業。  2.具以下相關經驗至少一項以上(需檢附相關證明)：  (1)具電子電路設計經驗。  (2)具通信設備類比/數位介面開發經驗。  (3)具通信系統整合設計經驗。  (4)具無線電機開發經驗。  (5)具天線系統建置經驗。  3.請檢附下列資料供書面審查：  (1)檢附大學及碩士班各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)。  (2)檢附碩士論文概述(未檢附者，視同資格不符)。  (3)國內外學術期刊發表論文紀錄。  (4)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (5)參加國、內外競賽獲獎證明。  (6)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。  (7)英文聽、說、讀、寫流利，並提供英文能力相關證明。 | 1.通信整合系統規劃、設計、系統整合及建置。  2.行動通信系統規劃、設計、系統整合及建置。  3.收發天線系統規劃、設計、系統整合及建置。  4.通資系統規格發展、系統分析與設計、系統安裝、測試評估、整體後勤規劃及技術文件發展等相關工作。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 資管  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機/資訊 | 1.理工相關學院碩士畢業;非理工學院頒發學位者，至少應修滿相關理工學分3分之2以上。  2.電子/電機/資訊等相關系所畢業為佳。  3.具備C++或C#程式設計經驗。  4.具備資料庫系統建置經驗。  5.熟悉Visual Studio或C++ Builder開發工具。  6.擅長開發GUI人機介面應用程式。  7.須檢附大學(含)以上各學年成績單、碩士論文概述及畢業證書影本供書面審查(未檢附者，視同資格不符)。  8.提供下列相關證明文件為佳，並納入書面審查加分項目：  (1)國內、外學術期刊發表(相關)論文紀錄。  (2)具專案管理或理工技術職類相關證照。  (3)參加國、內外競賽獲獎證明。  (4)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。  (5)英文聽、說、讀、寫流利並提供英文能力相關證明。 | 1.警衛安全監控系統開發。  2.通信遙控系統開發。  3.即時顯示系統開發。  4.技術文件發展等相關工作。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 資管  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機/資訊 | 1.理工相關學院碩士畢業;非理工學院頒發學位者，至少應修滿相關理工學分3分之2以上，或具有資訊管理或應用、資訊安全領域特殊人才相關國際證照**。**  2.具備光纖傳輸系統或資訊網路設備操作及維護等相關工作經驗(請檢附相關工作經歷證明)。  3.具備CCNA或CCNP相關專業證照為佳。  4.須檢附大學(含)以上各學年成績單、碩士論文概述及畢業證書影本供書面審查(未檢附者，視同資格不符)。  5.提供下列相關證明文件為佳，並納入書面審查加分項目：  (1)國內、外學術期刊發表(相關)論文紀錄。  (2)具專案管理或理工技術職類相關證照。  (3)參加國、內外競賽獲獎證明。  (4)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。  (5)英文聽、說、讀、寫流利並提供英文能力相關證明。 | 1.資訊網路系統及通資電基礎建設相關規劃、設計、開發、系統整合及建置。  2.資訊系統規格發展、系統分析與設計、系統安裝、測試評估、整體後勤規劃及技術文件發展等相關工作。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 資管  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 電子/電機/資訊 | 1.電子/電機等相關理工系所畢業。  2.熟悉專案管理、系統工程(電子/電機)及資訊管理等相關理論與實務為佳(請檢附相關證明)。  3.具國防工業工程或資訊管理等相關工作經驗3年以上(請檢附相關工作經歷證明)。  4.具以下工作經驗或證照為佳(請檢附相關證明或證照影本)：  (1)具備電子電機類技術士證照或相關專業證照。  (2)其他與工作內容所列項目相關經驗。  (3)英文聽、說、讀、寫流利並提供英文能力相關證明。  5.檢附大學(含)以上各學年成績單、碩士論文概述及畢業證書影本供書面審查(未檢附者，視同資格不符)。 | 專案管理、系統工程(電子/電機)、資訊管理或後勤管理。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 資管  中心 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 資訊/資管/資工 | 1.理工相關學院碩士畢業，非理工學院頒發學位者，至少應修滿相關理工學分3分之2以上，其畢業論文內容有積極相關性。  2.具以下工作經驗或證照為佳(請檢附相關證明或證照影本)：  (1)網頁式資訊系統開發。  (2)ASP.Net C#網頁程式開發。  (3)Java Servlet、JSP網頁程式開發。  (4)SQL Server、Oracle資料庫系統程式開發。  (5)C++、Java、Python、PowerShell程式開發。  (6)Windows、Linux作業系統核心程式開發。  (7)專案管理、營運管理、企業資源規劃(ERP)。  3.請檢附下列資料供書面審查：  (1)大學(含)以上各學年成績單。  (2)碩士論文概述。  (3)可資佐證項次2.工作經驗或證照之相關證明文件。  4.經歷加分項目(需檢附相關證明文件)：  (1)國內、外學術期刊發表(相關)論文。  (2)專案管理或理工技術職類相關證照。  (3)全民英檢中級(或相當於多益550分；托福筆試457分/電腦測驗137分/網路測驗47分)，或曾於英語系國家進修並獲碩士學位。 | 1.資訊系統規劃、設計及開發。  2.資料庫程式規劃、設計及開發。  3.軟體共通元件、程式風格及人機介面之規劃與設計。  4.軟體測試及構型管理。  5.專案管理、營運管理、企業資源規劃(ERP)等相關工作。 | 7員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
|  | 資管  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 電子/電機/資訊/資管/資科 | 1.資訊相關科系畢業。  2.1年(含)以上相關工作經驗(需檢附工作經歷證明)。  3.具資訊安全與軟體品保相關證照為佳。  4.熟悉Linux系統管理與維運為佳。 | 1.操作軟體工程/測試計畫之管理工具。  2.執行系統弱點檢測作業  3.處理資訊安全攻擊威脅及資訊安全事件  4.執行軟體測試相關作業。  5.執行軟體自動化測試程式維運作業。 | 2員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (70分合格，合格者方可參加筆試及口試)  **筆試40%：**  資訊安全知識(軟體工程品保/資訊系統安全防護，擇一卷)  (60分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 資管  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 電子/電機/資訊 | 1.電子/電機/資訊等相關科系畢業。  2.具以下工作經驗或證照為佳(請檢附相關證明或證照影本)：  (1)具備通信裝備及弱電系統操作保修等相關工作經驗。  (2)具備政府所核定丙級以上電子電機類技術士證照或相關專業證照。  (3)其他與工作內容所列項目相關經驗。  3.檢附最高學歷各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)。 | 1.通信整合系統、行動通信系統及收發天線系統等安裝測試  、參數設定、參數調校、測試資料分析及設備維護等相關工作。  2.上述系統安裝規範、系統驗收測試、技術手冊等發展。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (70分合格，合格者方可參加實作及口試)  **實作40%：**  通信線材及  接頭製作  (60分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 資管  中心 | 技術類 | 大學  畢業 | 37,000  |  45,000 | 資訊/資管/資工 | 1.資訊相關科系畢業。  2.具以下工作經驗或證照為佳(請檢附相關證明或證照影本)：  (1)網頁式資訊系統開發。  (2)ASP.Net C#網頁程式開發。  (3)Java Servlet、JSP網頁程式開發。  (4)SQL Server、Oracle資料庫系統程式開發。  (5)C++、Java、Python程式開發。  3.請檢附下列資料供書面審查：  (1)大學各學年成績單。  (2)可資佐證項次2.工作經驗或證照之相關證明文件。  4.經歷加分項目(請檢附相關證明)：  (1)專案管理或資訊技術職類相關證照。  (2)托福或多益或全民英檢成績證明。 | 1.資訊系統規劃、設計及開發。  2.資料庫程式規劃、設計及開發。  3.軟體測試及構型管理。  4.專案管理、營運管理、企業資源規劃(ERP)等相關工作。 | 3員 | 桃園  龍潭 | **書面審查20%**  (70分合格，合格者方可參加筆試及口試)  **筆試40%：**  網頁程式語言  (60分合格)  **口試40%**  (70分合格) |
|  | 策略會 | 研發類 | 碩士  畢業 | 55,000  |  65,000 | 航空/機械/電子/電機/系統工程/資訊工程/工業工程/物理 | 1.航空/機械/電子/電機/系統工程/資訊工程/工業工程/物理等相關理工系所畢業。  2.具學校社團重要幹部經驗。  3.具專案管理或計畫管理相關經驗為佳(請檢附相關工作經歷證明)。  4.請檢附大學(含)以上各學年成績單及碩士論文。如有下列文件，請於報名時一併提供審查：  (1)國內外學術期刊發表論文紀錄。  (2)國家考試資格、技術士技能檢定等相關證照影本。  (3)托福或多益或全民英檢成績證明。  (4)參加國、內外競賽獲獎證明。  (5)其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 1.國防科技管理。  2.國防科技資料庫內容建置、分析與維護。  3.研發循環內部控制。  4.策略研析與制度建立。  5.研考業務。 | 1員 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **書面審查40%**  (70分合格，合格者方可參加口試)  **口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 合計：研發類**164**員、技術類**180**員，合計**344**員 | | | | | | | | | | |

附件2

國家中山科學研究院特殊領域人才進用作業規定

一、特殊進用適用對象

非理工科系之特殊領域相關科系碩士(含)以上學歷：大學及碩士修滿與特殊領域相關課程24學分且具備特殊領域證照、競賽得名或特殊技能者，得報名參加本院公開招考。

二、相關專業證照、競賽性質、特殊技能等採計條件如附表

附表-特殊領域限制條件採計表

| 特殊領域 | 限制條件 | 內容 | 採計  審認 |
| --- | --- | --- | --- |
| 資訊安全 | 資訊管理或應用相關科系碩士(含)以上學歷 | 大學及碩士須修滿與資訊學科相關課程24學分。 | 相關證照、競賽性質、資安技能認定及科技技術年資採計，有疑義由資訊通信研究所及資訊管理中心共同成立審查小組審認之。 |
| 資安國際證照(本項適用對象須具備右列證照至少一項，且證照有效期必須超過招考報名截止日期) | (1)ISO 27001之資訊安全管理系統主導稽核員認證  (2)ECSA 資安分析專家認證  (3)EDRP 資安災害復原專家認證  (4)CCISO 資安長/EISM資安經理人認證  (5)CISSP 資訊安全系統專家認證  (6)CSSLP 資訊安全軟體開發專家認證  (7)CCIE Security 認證  (8)RHCA Red Hat Linux系統安全調校認證  (9)LPT 滲透測試專家認證  (10)Guidance EnCase 國際專業鑑識認證  (11)CHFI 資安鑑識調查專家(數位鑑識) |
| 國際重要資安競賽(本項適用對象須具備右列2年內國際資安競賽獲得前10名(含)至少一項) | (1)Defcon CTF Qualifier  (2)Plaid CTF  (3)Boston Key Party CTF (BKPCTF)  (4)HITCON CTF  (5)Hack.lu CTF  (6)RuCTFe |
| 資安特殊技能 | (1)對資訊安全領域有重要成就或傑出表現(如挖掘重要資訊系統弱點，經正常管道提報，避免重大損害)。  (2)曾於Defcon、BlackHat國際重大論壇發表論著。  (3)曾挖掘零時差弱點於HITCON ZERODAY或Vulreport經審認發表。 |
| 軟體開發與管理 | 軟體開發與管理相關國際證照(本項適用對象須具備右列證照至少一項，且證照有效期必須超過招考報名截止日期) | (1)OCM：Oracle Certified Master  (2)Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)  (3)Microsoft Certified Solutions Expert(MCSE)  (4)Red Hat Certified Engineer(RHCE)  (5)Cloudera Certified Administrator for Apache Hadoop(CCAH)  (6)Cloudera Certified Professional (CCP Data Engineer)  (7)Certified Software Quality Engineer(CSQE)  (8)Certified Software Testing Engineer(CSTE)  (9)ERP軟體顧問師(ERP Software Consultant)  (10)進階ERP規劃師(Advanced ERP Planner)  (11)ERP導入顧問師(ERP Implementation Consultant)  (12)OMG Certified UML Professional (OCUP) Advanced  (13)Certified CMMI for Development Supplement Instructor  (14)Certified CMMI Professional  (15)BI 企業顧問師(BI Enterprise Consultant)  (16)BI 軟體顧問師(BI Software Consultant)  (17)BI企業績效管理顧問師(BI performance Management Consultant) | 相關證照認定及科技技術年資採計，有疑義由資訊通信研究所或資訊管理中心成立審查小組審認之。 |

三、一般事項

(一)相關證照、競賽性質、特殊技能認定及科技技術年資採計，有疑義由提出之專業單位成立審查小組審認。

(二)如特殊領域牽涉範圍超出單一專業，則有疑義由提出之專業單位主辦，召集相關單位共同成立審查小組審認。

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 國家中山科學研究院106年人力進用  聯絡方式及職缺公告截止日 | | | | | | |
| 單位 | 簡章  項次 | 研發類 | 技術類 | 進用  員額 | **公告 天數** | 聯絡人  辦公室電話 信箱 |
| **飛彈所** | **1-51** | **39** | **54** | **93** | **20** | [amethyst1219@ncsist.org.tw](mailto:amethyst1219@ncsist.org.tw)  李日新副組長：352229  丁樂珍小姐：352232  藍巧茹小姐：352026 |
| **化學所** | **52-81** | **26** | **51** | **77** | **30** | macle@ncsist.org.tw  施佳男副組長：358219  溫麗秋小姐：358667 |
| **材電所** | **82-118** | **30** | **28** | **58** | **14** | 1934pm@ncsist.org.tw  陳彥良組長：357010  劉佳珊小姐：357268  黃瑞婷小姐：357321 |
| **系發 中心** | **119-154** | **32** | **21** | **53** | **30** | ling@ncsist.org.tw  張運生組長：355022  朱瑞琪小姐：355235 |
| **系維 中心** | **155-161** | **5** | **3** | **8** | **20** | ilscmail@ncsist.org.tw  吳建興組長：350711  龍一蘭小姐：350712 |
| **系製 中心** | **162-173** | **7** | **17** | **24** | **30** | rainbow@ncsist.org.tw  許順峰組長：313113  毛信元先生：313123 |
| **資管 中心** | **174-186** | **24** | **6** | **30** | **30** | [judyzheng@ncsist.org.tw](mailto:judyzheng@ncsist.org.tw)  趙和謙組長：350109  鄭文怡小姐：350086 |
| **策略會** | **187** | **1** | **0** | **1** | **30** | daniel888@ncsist.org.tw  邱進忠組長：356314  王雄師先生：356150 |
| 人資處 | 其他事項  陳怡妃小姐  (03)4712201轉350876  yifei@ncsist.org.tw | | | | | |

職缺公告截止日為實際公告日期加計各單位公告天數，遇假日延後兩天。

附件4

**履　　　　　歷　　　　　表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★姓名 |  | 英文姓名 | |  | | ★身分證  號碼 | | | | |  | | | | 最近三個月  1吋半身脫帽照片 |
| 出生地 |  | ★出生日期 | | 年月日 | | 婚姻 | | | | | □已婚 □未婚 | | | |
| ★兵役狀況 | | □役畢□免役□未役□服役中(退役時間：　　　　　) | | | | | | | | | | | | |
| ★電子郵件 | |  | | | | | | | | | | | | |
| ★通訊處 | 戶籍  地址 |  | | | | | | | | | | 行動電話 | | |  |
| 通訊  地址 |  | | | | | | | | | | 連絡電話 | | |  |
| 居住國外在台聯絡人員  (緊急聯絡人) | |  | | 行動電話 | |  | | | | | 連絡電話 | | |  |
| ★  學歷 | 學校名稱 | | | | 院系科別 | | | | 學位 | | | 起迄時間 | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 註：學歷欄按所獲學位，由高至低順序填寫(例：按博士－＞碩士－＞學士順序)。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★  經歷 | 服務機關名稱 | | | | 職稱(工作內容) | | | | | | | | 起迄時間 | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 家庭狀況  ★ | 稱謂 | 姓名 | | | 職業 | | | | | 服務機關 | | | 連絡(行動)電話 | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **□是 有在中科院任職之親屬及朋友者請填寫以下欄位 □否 以下欄位不需填寫** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三親等親屬及朋友  在中科院任職之  ★ | 關係(稱謂) | | 姓名 | | | | | 單位 | | | | | | 職稱 | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 身體 | 身高：　　　　　　　公分 | | | | 體重：　　 　　　公斤 | | | | | | | | 血型： 　　　型 | | |
| 其他 | 原住民 | □山地 □平地 | | | | | | | | 族 別：　　　 　　　　　族 | | | | | |
| 身心  障礙 | 殘障等級：　　　　　　　　　度 | | | | | | | | 殘障類別：　　　　　　　　　障(類) | | | | | |

備註：有★為必填欄位

|  |
| --- |
| 簡要自述(請以1頁說明) |
|  |

(本表若不敷使用請自行延伸)　　　　　　　　　　填表人：　　　 　　　（簽章）

(提醒：請依本履歷規定格式撰寫(含履歷表、自傳及報考項次之學歷、經歷條件需求資料)，視需要可自行增加，整份履歷表必須彙整為一個檔案上載)

**依進用員額需求表學歷、經歷條件需求資料，依序自行增修**

1. 畢業證書(符合報考職缺學歷要求之畢業證書及最高學歷畢業證書)

(請貼上畢業證書圖檔)

1. 學歷文件(大學成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上大學成績單圖檔)

1. 學歷文件(碩、博士成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上碩、博士成績單圖檔)

1. 英文測驗證明文件(本項視報考工作之編號學歷、經歷條件需求，如全民英檢、多益、托福…等)

(請貼上英文證明文件圖檔)

1. 具各公營機構相關技能訓練證照或證明(請檢附訓練時數300小時以上相關證明)或其它相關證照(本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上證照正反面圖檔)

1. 相關專業工作經歷證明(本項視學歷、經歷條件需求，本項需公司開出之證明文件)

(請貼上工作經歷證明圖檔)

七、其它補充資料或特殊需求(本項視學歷、經歷條件需求，或補充自身相關專業之專題、論文、獲獎文件…等資料)

附件5

**國家中山科學研究院**

**各類聘雇員工參加招考報名申請表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現職單位  （至二級） | | 姓名  (身分證號碼) | 職類及級職 | 最高學歷  (含科/系/所) | |
|  | |  |  |  | |
| 擬參加甄選單位職缺 | | | | | |
| 報考單位(或項次) | | | 職類 | | 職缺 |
|  | | |  | |  |
| 本人簽章 | 二級單位 | | 一級單位主管批示 | | |
| 電話： |  | |  | | |
| 一級人事單位 | |
|  | |

備註：非本院現職員工免填。